Công ty TNHH Inventec Appliances (Việt Nam) ---	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ---
Số: 02/2026 - ĐKMT IACV V/v đăng ký môi trường cho dự án đầu tư, cơ sở	*Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2026*

Kính gửi: Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Inventec Appliances (Việt Nam) là chủ đầu tư của Dự án *"Sản xuất đồ điện tử gia dụng, linh kiện và thiết bị điện tử Inventec Appliances Việt Nam"*, thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18 tháng 05 năm 2026 về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường.

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 13, Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội.

- Giấy chứng nhận đầu tư số: 4356076845 thay đổi lần thứ 6 ngày 25 tháng 08 năm 2026 do Ban Quản lý Các khu công nghệ cao và khu công nghiệp cấp.

- Giấy đăng ký kinh doanh số: 0110113951 thay đổi lần thứ 4 ngày 30 tháng 07 năm 2026 do Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính Doanh nghiệp cấp.

- Người đại diện theo pháp luật/ Người đứng đầu của Công ty TNHH Inventec Appliances (Việt Nam): Ông WU, CHIEH - Chức vụ: Tổng Giám Đốc.

- Điện thoại: 02438182758; Fax: .....; e-mail:.....

Công ty TNHH Inventec Appliances (Việt Nam) đăng ký môi trường cho Dự án *"Sản xuất đồ điện tử gia dụng, linh kiện và thiết bị điện tử Inventec Appliances Việt Nam"*với các nội dung sau:

1. Thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở

1.1. Tên dự án đầu tư, cơ sở: Dự án *"Sản xuất đồ điện tử gia dụng, linh kiện và thiết bị điện tử Inventec Appliances Việt Nam"*.

1.2. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, cơ sở; nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án đầu tư

1.2.1. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, cơ sở: Lô 13, Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội. (Thuê lại Tòa V và Tòa G của Công ty TNHH Hệ thống năng lượng tại Việt Nam theo Hợp đồng IACV-2023-OT-OT-0131).

1.2.2. Nguồn vốn: 759.000.000.000 đồng (Bảy trăm năm mươi chín tỷ đồng Việt Nam) tương đương 33.000.000 USD (Ba mươi ba triệu Đô la Mỹ).

1.2.3. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:

1.2.3.1. Tiến độ góp vốn:

- Phần vốn góp 69.000.000.000 đồng, tương đương 3.000.000 USD do nhà đầu tư góp trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tiến độ góp vốn: Đã góp đủ.
- Phần vốn góp tăng thêm 690.000.000.000 đồng, tương đương 30.000.000 USD (trong đó tiền mặt: 16.006.321,83 USD và máy móc thiết bị: 13.993.678,17 USD): theo báo cáo, Nhà đầu tư đã góp đủ.

1.2.3.2. Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành

- Hoàn thành các thủ tục pháp lý: Tháng 5/2023 đến hết tháng 6/2023.
- Lắp đặt máy móc thiết bị: Tháng 7/2023.
- Sản xuất thử: Từ tháng 08/2023.
- Bắt đầu sản xuất chính thức: Từ tháng 9/2023.
- Sản xuất, gia công các thiết bị hỗ trợ chơi game: Theo báo cáo đã đi vào hoạt động từ tháng 02/2025.
- Sản xuất bộ vỏ bảo vệ của bảng mạch bộ định tuyến không dây; Sản xuất hộp đen định vị và quản lý xe có modem di động (không pin); Sản xuất, gia công mô-đun kiểm soát truy cập mở cửa xe ô tô điện; Sản xuất, gia công mô-đun tích hợp UWB /BLE Anchor; Sản xuất, gia công bộ điều khiển buồng lái tích hợp: Đã đi vào hoạt động từ tháng 3/2026.
- Sản xuất, gia công cụm sấy của máy in; Sản xuất, gia công bộ phận băng tải chuyển hình của máy in; Sản xuất, gia công khung máy in; Sản xuất, gia công module truyền thông không dây, module Wi-Fi, Bluetooth, RF module, bo mạch điện tử, cảm biến và các linh kiện điện tử khác: Dự kiến thực hiện từ tháng 9/2026.

1.3. Quy mô; công suất; công nghệ và loại hình sản xuất của dự án đầu tư, cơ sở:

1.3.1. Quy mô

- Dự án "Sản xuất đồ điện tử gia dụng, linh kiện và thiết bị điện tử Inventec Appliances Việt Nam" được thực hiện trên khu đất có diện tích: 27.780,04m2 (Thuê lại Tòa V và Tòa G của Công ty TNHH Hệ thống năng lượng tại Việt Nam theo Hợp đồng IACV-2023-OT-OT-0131).

- Công suất dự kiến: 12.000.000 sản phẩm/năm.

1.3.2. Công suất

- Theo số liệu thống kê thực tế, tổng sản lượng sản xuất hiện nay của Nhà máy đạt 3.800.975 sản phẩm/năm, tương đương khoảng 31,7% công suất thiết kế. Cụ thể như sau:

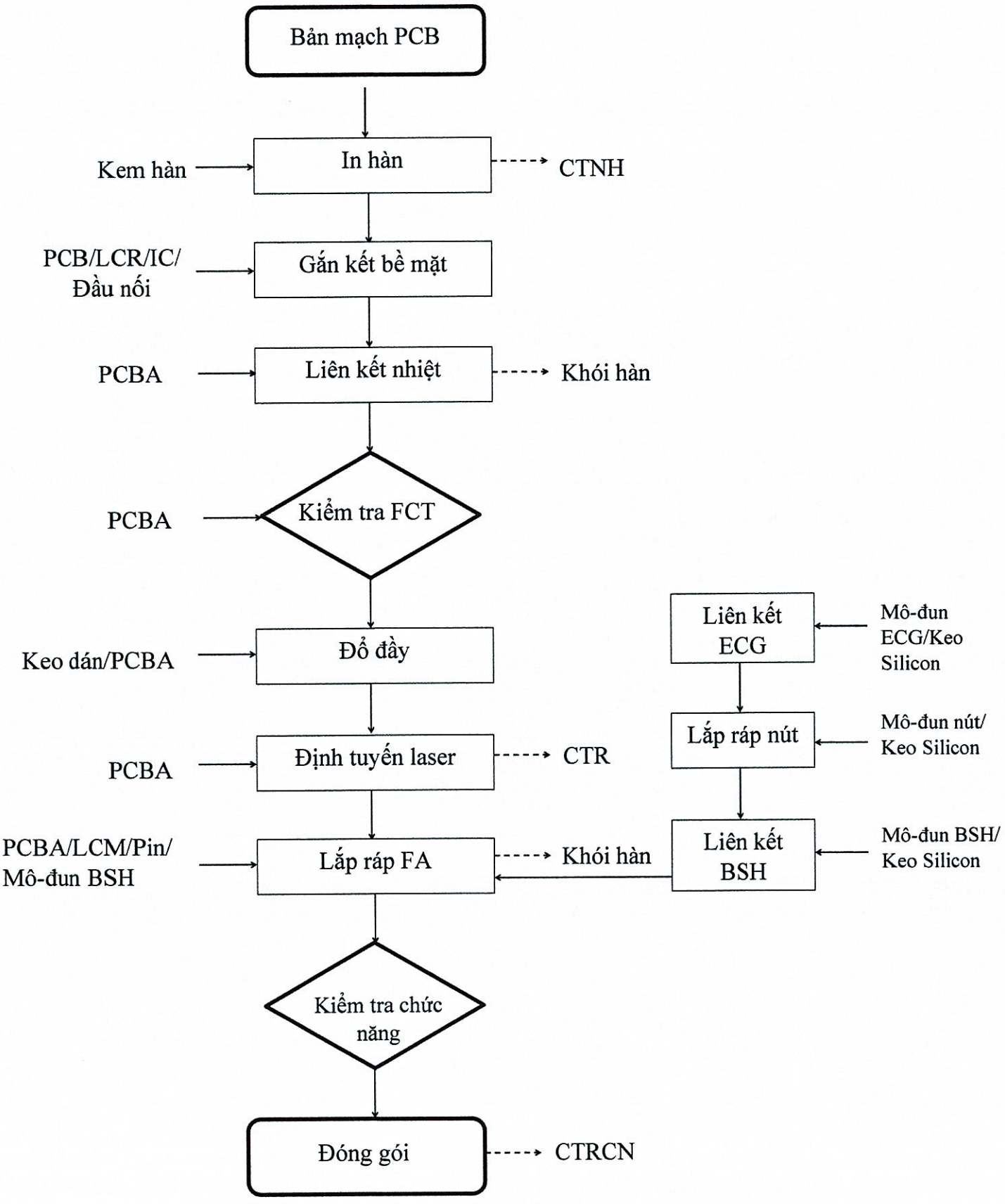
STT	Mục tiêu	Sản phẩm cụ thể	Sản phẩm/năm	
			Năm 2025	Năm 2024
1	- Sản xuất, gia công loa không dây - Sản xuất, gia công tai nghe không dây - Sản xuất, gia công hệ thống âm thanh hi-fi - Sản xuất, gia công thiết bị hỗ trợ gọi video hội nghị	Loa, tai nghe, Adapter (USB)	262.871	0
2	- Sản xuất, gia công các thiết bị hỗ trợ chơi game	Tay cầm chơi game	91.086	0
3	- Sản xuất, gia công máy tính đồ thị	Máy tính tiền	1.678.241	565.794
4	- Sản xuất, gia công thiết bị điện tử đeo thông minh	Đồng hồ thông minh	1.391.475	1.809.759
5	- Sản xuất, gia công camera hành trình thông minh	Camera, NVR (Network Video	93.823	115.773

	- Sản xuất, gia công đầu chuyển	Recorder)		
6	- Sản xuất, gia công thiết bị ngoại vi máy tính	Má tính cầm tay	167.010	47.799
7	- Sản xuất, gia công bảng mạch điện tử	Bản mạch cổng sạc lightning	116.469	0
Tổng sản phẩm			3.800.975	2.539.125

(Nguồn: Báo cáo đề xuất điều chỉnh dự án)

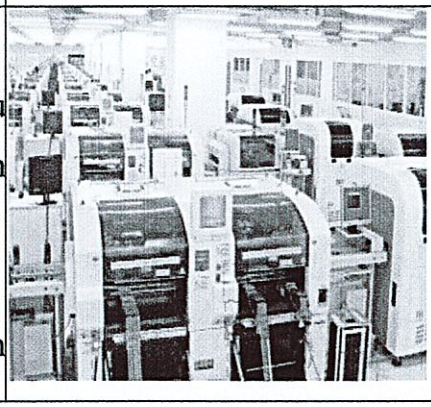
1.3.3. Công nghệ sản xuất của dự án:

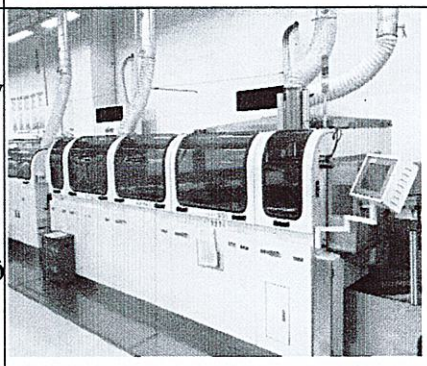
- **Công nghệ sản xuất, gia công đồng hồ thông minh**

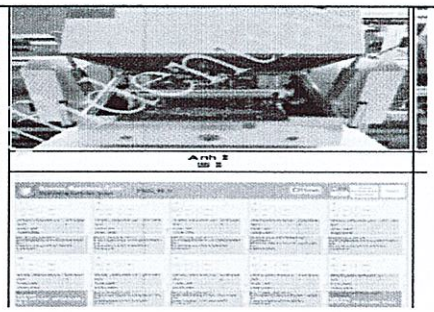
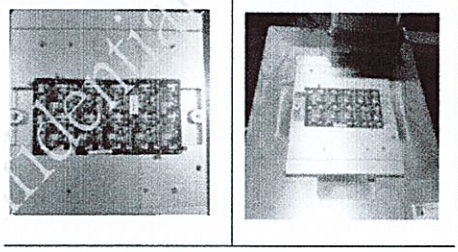


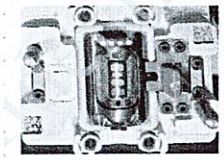
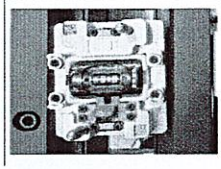
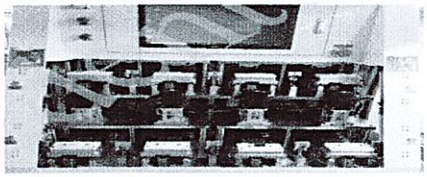
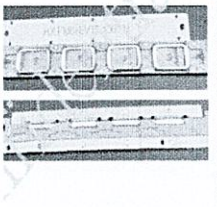
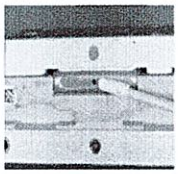
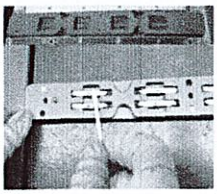
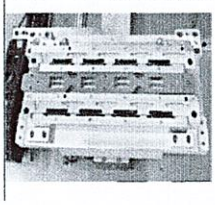
Hình 1. Quy trình sản xuất, gia công đồng hồ thông minh

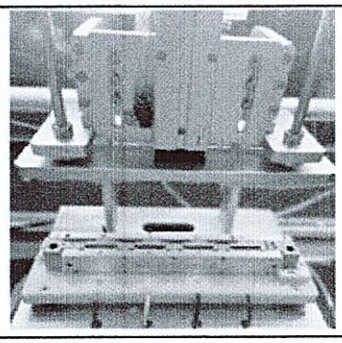
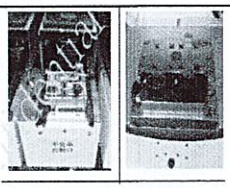
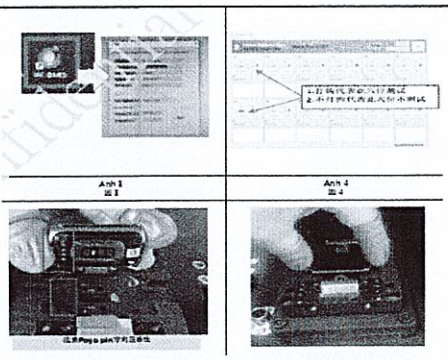
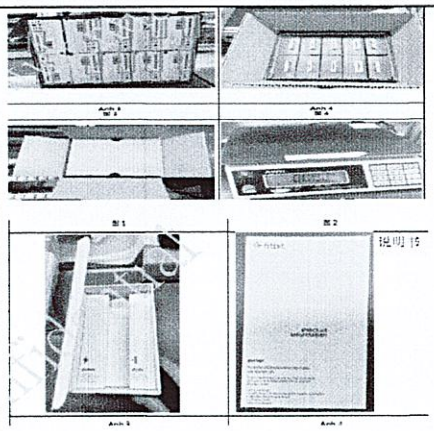
- Thuyết minh quy trình sản xuất, gia công:

Các bước	Mô tả quy trình	Ảnh minh họa
1. In hàn	Hàn chính xác 1. Kem hàn được in chính xác lên miếng đệm PCB thông qua khuôn cắt bằng laser Các thông số chính: Độ dày khuôn: 0,1-0,15mm (4-6 mil) Kích thước khẩu độ: 95% diện tích miếng đệm (bước tối thiểu 0,2mm) Căn chỉnh PCB được cố định trên máy in bằng lực giữ chân không Hệ thống Vision đạt được sự căn chỉnh khuôn với miếng đệm <±25µm Dụng cụ: Đăng ký cơ học 3 điểm Căn chỉnh camera chuẩn tùy chọn Hoạt động của gạt Hai gạt bằng thép không gỉ (góc 60°) tạo lực 5-15kg Tốc độ in: 20-80mm/giây	 Máy in kem hàn
2. Gắn kết bề mặt	Vị trí linh kiện chính xác Thiết bị gắn trên bề mặt (điện trở, tụ điện, IC) được định vị chính xác trên các miếng đệm PCB được hàn Hoạt động Pick-and-Place Vòi phun chân không xử lý các linh	

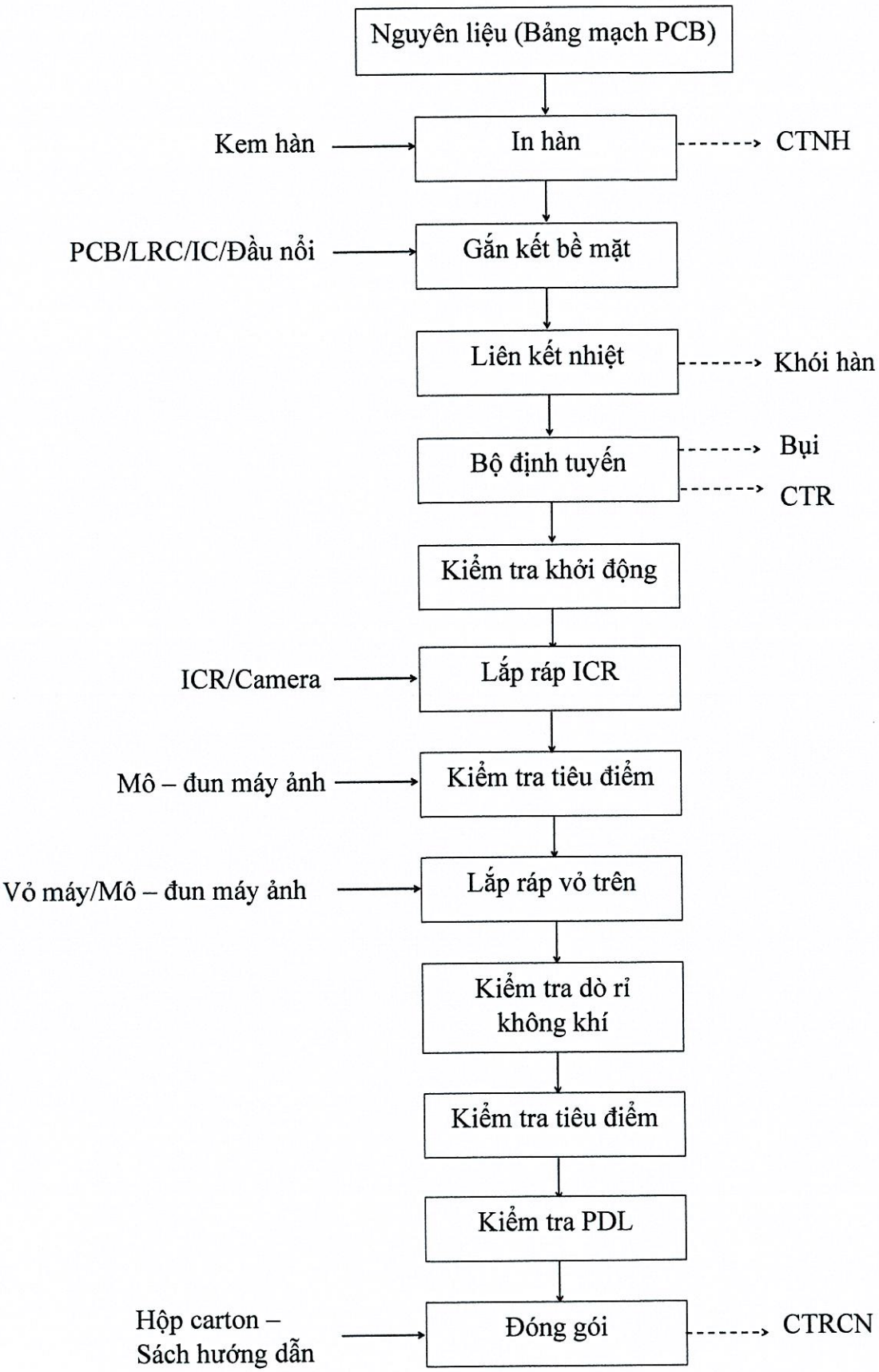
	kiện với: Lực nhấc 400-800g Độ chính xác trục Z 20-50µm Hệ thống nạp: Cuộn băng (8/12/16/24mm) Tùy chọn khay/ống cho IC Căn chỉnh hỗ trợ thị giác Hệ thống camera kép thực hiện: Kiểm tra dây dẫn linh kiện (2D/3D) Nhận dạng điểm chuẩn (độ phân giải 0,01mm)	Máy nhặt và đặt linh kiện
3. Liên kết nhiệt	Cơ chế liên kết nhiệt Gia nhiệt có kiểm soát làm tan chảy kem hàn để tạo thành: Mối nối kim loại (lớp IMC Cu6Sn5) Liên kết cơ học (cường độ cắt >5kg/mm²) Đặc điểm quy trình Hồ sơ nhiệt độ: Làm nóng trước: 1-3°C/giây đến 150-180°C Ngâm: 60-120 giây ở 180-200°C Nung chảy lại: Đỉnh 235-250°C (SnAgCu) Làm mát: 1-4°C/giây đến <100°C Kiểm soát khí quyển: Nitơ được thanh lọc (O_2 <500ppm) Khói được thu gom và xử lý bằng	 Cơ chế liên kết nhiệt

	đường ống	
4.Kiểm tra FCT	Kiểm tra chức năng tự động được thực hiện trên các cụm PCB đã hoàn thiện bằng cách sử dụng phần mềm và đồ gá kiểm tra chuyên dụng. Quy trình bao gồm: Lập trình phần mềm cơ sở Xác thực nguồn - Đo điện áp/dòng điện Kiểm tra giao tiếp - Xác minh giao thức (UART/I2C/SPI) Kiểm tra chức năng tương tự - Xác thực tính toàn vẹn của tín hiệu và hiệu suất	 Kiểm tra chức năng PCBA
5.Đổ đầy	Quy trình đổ đầy (Hai bước) 1. Hệ thống phân phối tự động áp dụng đồng đều epoxy đổ đầy xung quanh chu vi của IC mục tiêu 2. Chuyển đến lò đối lưu để đóng rắn nhanh	
6.Máy định tuyến laser	Hệ thống cắt laser Phân tách chính xác các PCBA được kết nối thành các đơn vị riêng lẻ, chuẩn bị chúng cho việc lắp ráp sản phẩm cuối cùng.	

	Phế liệu cắt PCB sẽ được chuyển đến kho phế liệu	
7.Liên kết ECG	Quy trình lắp ráp cảm biến ECG (vào vỏ dưới) 1. Phân phối keo tự động Bôi keo silicon chính xác xung quanh khu vực cảm biến ECG của vỏ dưới bằng thiết bị phân phối tự động. 2. Căn chỉnh và liên kết mô-đun cảm biến ECG với bề mặt đã xử lý với độ chính xác định vị ở cấp độ micron. 3. Quy trình đóng rắn Duy trì áp suất không đổi trong 3 giờ để đạt được quá trình trùng hợp keo hoàn toàn.	   Máy liên kết ECG
8.Lắp ráp nút	Quy trình lắp ráp nút (3 bước) 1. Ứng dụng keo dán tự động: Thoa đều keo dán silicon xung quanh khu vực ECG của vỏ dưới bằng thiết bị phân phối tự động. 2. Liên kết ECG: Liên kết chính xác thành phần ECG với vỏ dưới. 3. Làm đông bằng áp suất: Duy trì áp suất liên kết và để đông tĩnh trong 3 giờ để bám dính hoàn toàn. Hoàn tất quy trình: Lắp ráp nút được hoàn thiện sau khi đông.	   

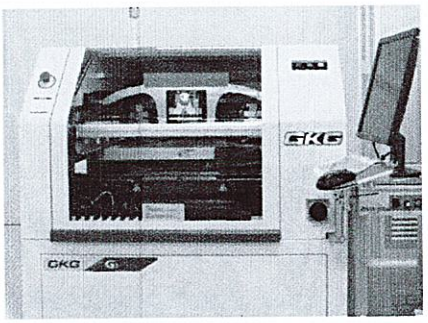
9.Liên kết BSH	Quy trình liên kết BSH (3 bước) 1. Phân phối tự động: Thoa đều keo silicon xung quanh khu vực ECG của vỏ dưới bằng hệ thống phân phối tự động. 2. Liên kết thành phần ECG với vỏ dưới theo sự căn chỉnh chính xác. 3. Làm đông & ổn định: Duy trì áp suất và để đông cứng tĩnh trong 3 giờ để hoàn tất lắp ráp.	
10. Lắp ráp FA	Lắp ráp LCM, pin, động cơ và PCBA vào mô-đun khung giữa.	
11.Kiểm tra chức năng	Được sử dụng để kiểm tra chức năng của các thiết bị lắp ráp hoàn chỉnh. Sử dụng các thiết bị kiểm tra tự động chuyên dụng và phần mềm để tự động thực hiện các thử nghiệm chức năng mô phỏng, bao gồm màn hình, độ rung, Bluetooth (BT) và NFC.	
12. Đóng gói	Đóng gói các sản phẩm PASS đã thử nghiệm vào hộp quà tặng, cùng với dây đeo đồng hồ và hướng dẫn sử dụng. Sau đó, đặt các hộp quà tặng vào thùng carton chính, in nhãn, cân chúng và cuối cùng là niêm phong các thùng carton.	

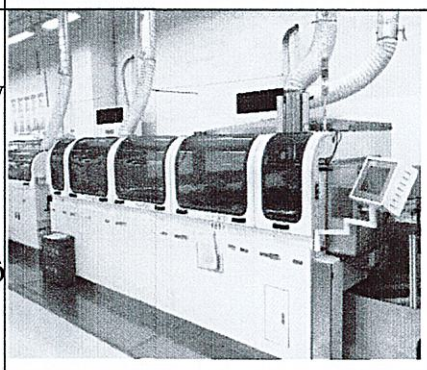
- **Công nghệ sản xuất, gia công camera**

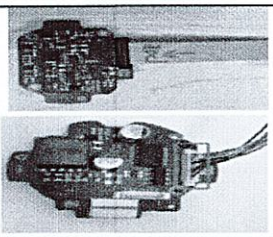
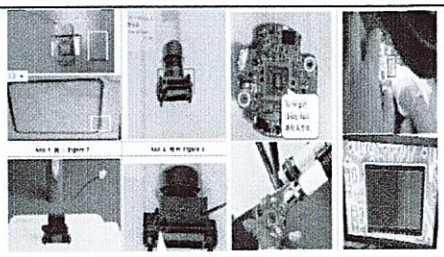


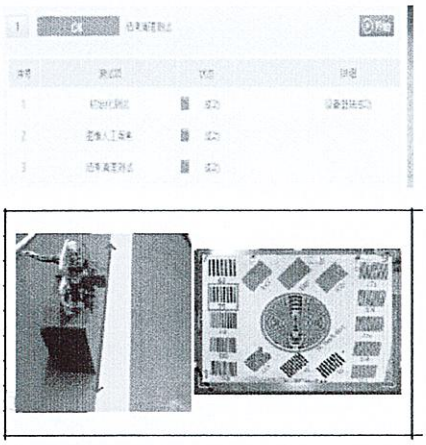
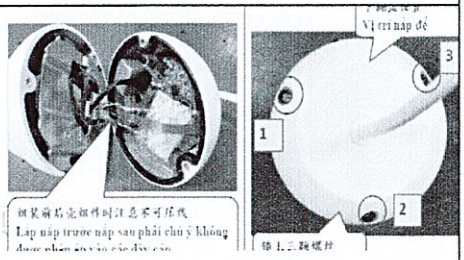
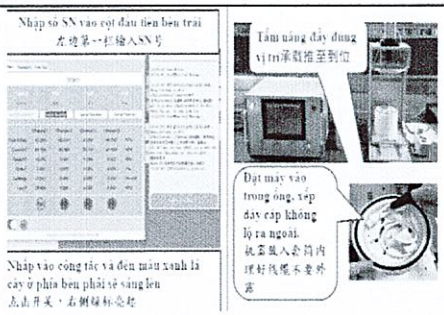
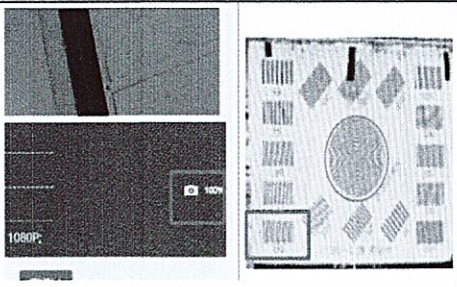
Hình 2. Quy trình sản xuất, gia công camera

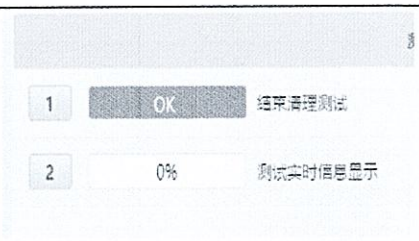
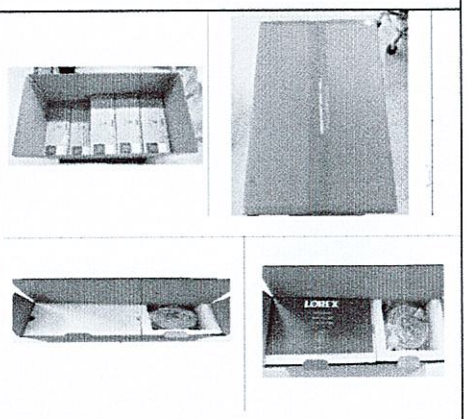
- Thuyết minh quy trình sản xuất, gia công:

Các bước	Mô tả quy trình	Ảnh minh họa
1. In hàn	Hàn chính xác 1. Kem hàn được in chính xác lên miếng đệm PCB thông qua khuôn cắt bằng laser Các thông số chính: Độ dày khuôn: 0,1-0,15mm (4-6 mil) Kích thước khẩu độ: 95% diện tích miếng đệm (bước tối thiểu 0,2mm) Căn chỉnh PCB được cố định trên máy in bằng lực giữ chân không Hệ thống Vision đạt được sự căn chỉnh khuôn với miếng đệm <±25µm Dụng cụ: Đăng ký cơ học 3 điểm Căn chỉnh camera chuẩn tùy chọn Hoạt động của gạt Hai gạt bằng thép không gỉ (góc 60°) tạo lực 5-15kg Tốc độ in: 20-80mm/giây	 Máy in kem hàn

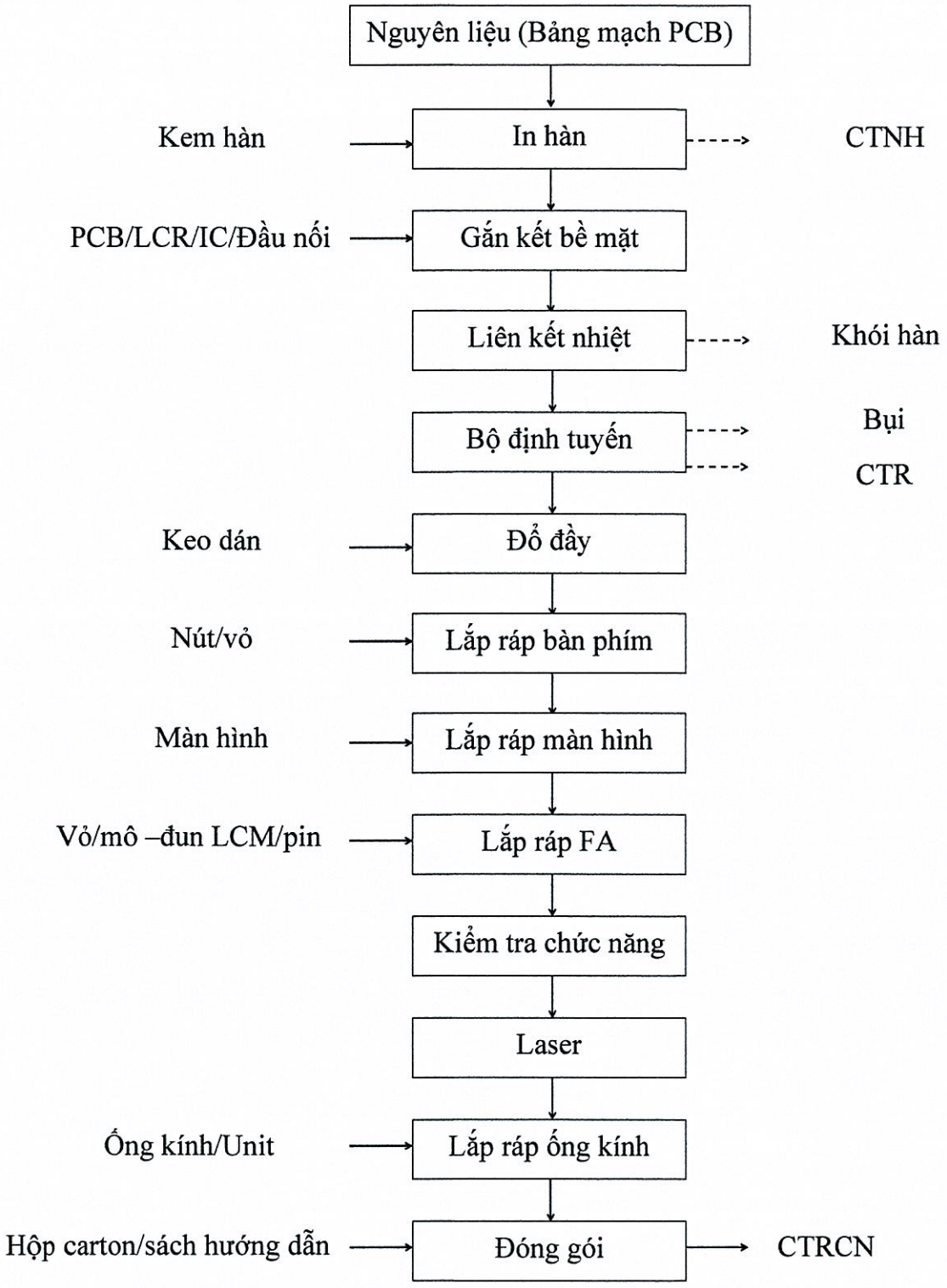
2. Gắn kết bề mặt	Vị trí linh kiện chính xác Thiết bị gắn trên bề mặt (điện trở, tụ điện, IC) được định vị chính xác trên các miếng đệm PCB được hàn Hoạt động Pick-and-Place Vòi phun chân không xử lý các linh kiện với: Lực nhấc 400-800g Độ chính xác trục Z 20-50µm Hệ thống nạp: Cuộn băng (8/12/16/24mm) Tùy chọn khay/ống cho IC Căn chỉnh hỗ trợ thị giác Hệ thống camera kép thực hiện: Kiểm tra dây dẫn linh kiện (2D/3D) Nhận dạng điểm chuẩn (độ phân giải 0,01mm)	 Máy nhặt và đặt linh kiện
3. Liên kết nhiệt	Cơ chế liên kết nhiệt Gia nhiệt có kiểm soát làm tan chảy kem hàn để tạo thành: Mối nối kim loại (lớp IMC Cu6Sn5) Liên kết cơ học (cường độ cắt >5kg/mm²) Đặc điểm quy trình Hồ sơ nhiệt độ: Làm nóng trước: 1-3°C/giây đến 150-180°C Ngâm: 60-120 giây ở 180-200°C	 Cơ chế liên kết nhiệt

	Nung chảy lại: Đỉnh 235-250°C (SnAgCu) Làm mát: 1-4°C/giây đến <100°C Kiểm soát khí quyển: Nitơ được thanh lọc (O_2 <500ppm) Khói được thu gom và xử lý bằng đường ống	
4.Bộ định tuyến	Máy định tuyến Phân tách chính xác các PCBA được kết nối thành các đơn vị riêng lẻ, chuẩn bị chúng cho việc lắp ráp sản phẩm cuối cùng. Phế liệu cắt PCB sẽ được chuyển đến kho phế liệu bụi được thu gom và xử lý bằng đường ống	  Máy định tuyến
5. Kiểm tra khởi động	Khách hàng cung cấp công cụ kiểm tra và sử dụng PC để tải FW, số sê-ri và địa chỉ MAC xuống bo mạch chủ	
6. Lắp ráp ICR	1. Vệ sinh ICR dưới CCD để đảm bảo không có bụi trước khi lắp vào ống kính 2. Kiểm tra trực quan ống kính dưới CCD để đảm bảo không có bụi trước khi lắp vào bo mạch chính	

7. Kiểm tra tiêu điểm	Khách hàng cung cấp công cụ kiểm tra, Bo mạch chủ được kết nối với PC thông qua cáp mạng Sử dụng biểu đồ kiểm tra tiêu cự để quan sát hình ảnh chụp và điều chỉnh độ rõ nét của ống kính. Đảm bảo rằng mẫu nhiễu là bình thường và không bị mờ	
8.Lắp ráp vỏ trên	Lắp ráp mô-đun MB vào vỏ trên và dưới, vặn chặt 3 vít, Cho chất hút ẩm vào	
9. Kiểm tra rò rỉ không khí	Thiết bị được kiểm tra khả năng chống thấm nước Sử dụng các công cụ kiểm tra và dụng cụ kiểm tra đặc biệt do khách hàng cung cấp Sản phẩm được kiểm tra tự động sau khi được đặt trong buồng thử nghiệm. Yêu cầu chống thấm nước: IPX6	
10. Kiểm tra tiêu điểm	Sử dụng công cụ kiểm tra được cung cấp để kết nối thiết bị với PC thông qua cáp mạng để thực hiện kiểm tra hình ảnh trên thiết bị. Xác nhận rằng hình ảnh không bị mờ và không có đốm đen trên màn hình	

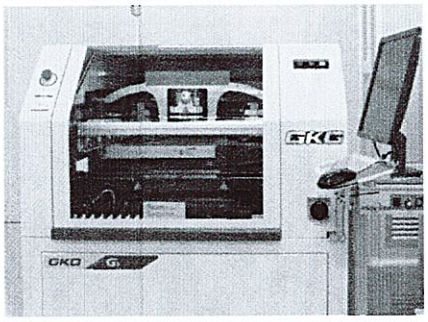
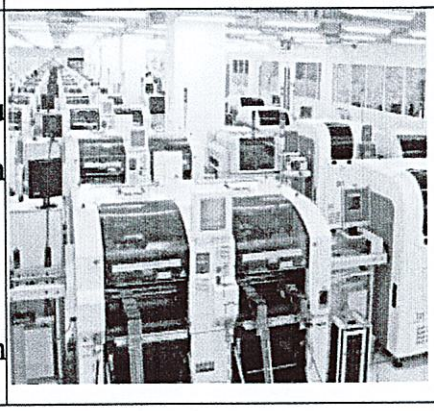
11.Kiểm tra PDL	Sử dụng công cụ kiểm tra do khách hàng cung cấp, kết nối thiết bị với PC thông qua cáp mạng, tải xuống chương trình cơ sở của người dùng	
12. Đóng gói	Đóng gói các sản phẩm PASS đã thử nghiệm vào hộp quà tặng, cùng với dây đeo đồng hồ và hướng dẫn sử dụng. Sau đó, đặt các hộp quà tặng vào thùng carton chính, in nhãn, cân chúng và cuối cùng là niêm phong các thùng carton.	

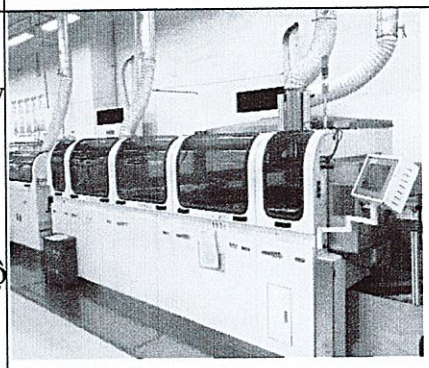
- **Công nghệ sản xuất, gia công máy tính đồ thị**

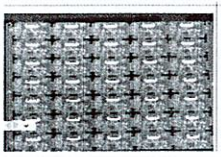
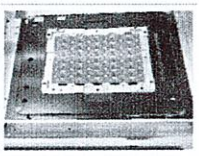
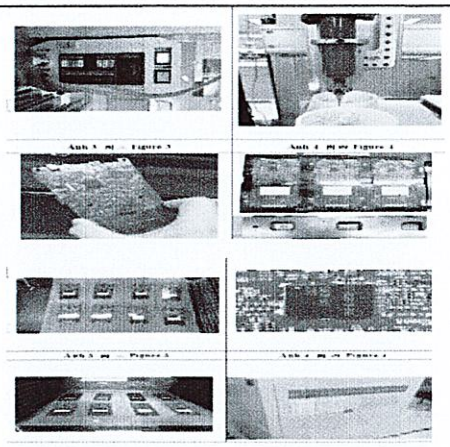
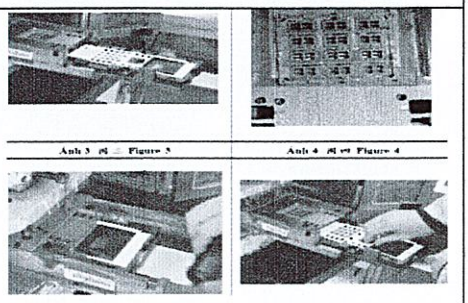


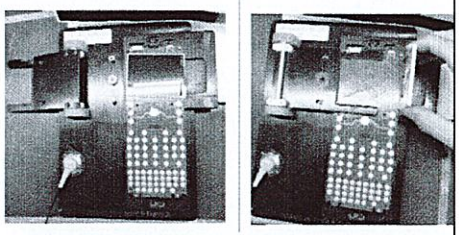
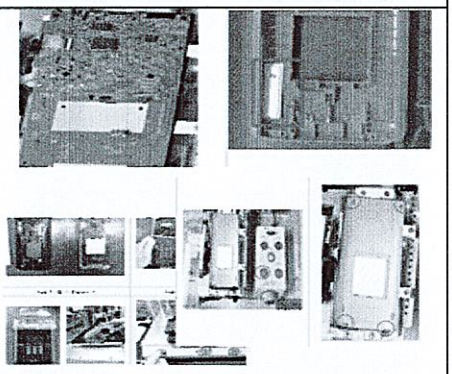
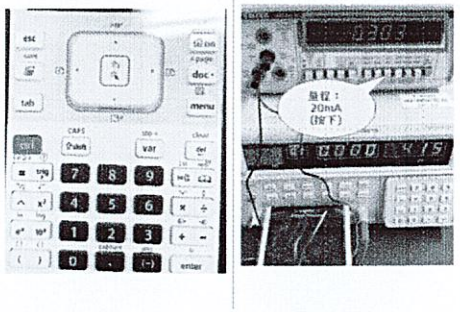
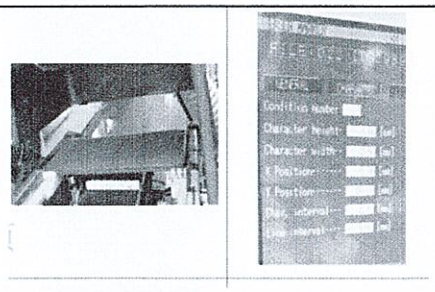
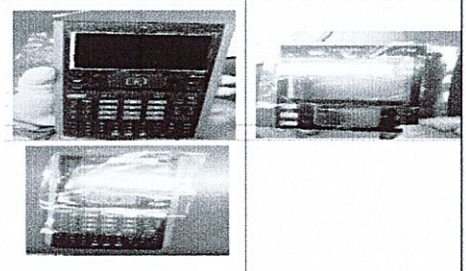
Hình 3. Quy trình sản xuất, gia công máy tính đồ thị

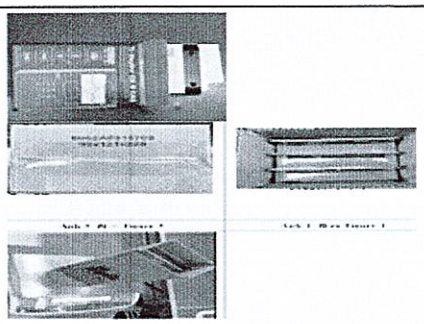
- Thuyết minh quy trình sản xuất, gia công:

Các bước	Mô tả quy trình	Ảnh minh họa
1. In hàn	Hàn chính xác 1. Kem hàn được in chính xác lên miếng đệm PCB thông qua khuôn cắt bằng laser Các thông số chính: Độ dày khuôn: 0,1-0,15mm (4-6 mil) Kích thước khẩu độ: 95% diện tích miếng đệm (bước tối thiểu 0,2mm) Căn chỉnh PCB được cố định trên máy in bằng lực giữ chân không Hệ thống Vision đạt được sự căn chỉnh khuôn với miếng đệm <±25µm Dụng cụ: Đăng ký cơ học 3 điểm Căn chỉnh camera chuẩn tùy chọn Hoạt động của gạt Hai gạt bằng thép không gỉ (góc 60°) tạo lực 5-15kg Tốc độ in: 20-80mm/giây	 Máy in kem hàn
2. Gắn kết bề mặt	Vị trí linh kiện chính xác Thiết bị gắn trên bề mặt (điện trở, tụ điện, IC) được định vị chính xác trên các miếng đệm PCB được hàn Hoạt động Pick-and-Place Vòi phun chân không xử lý các linh	

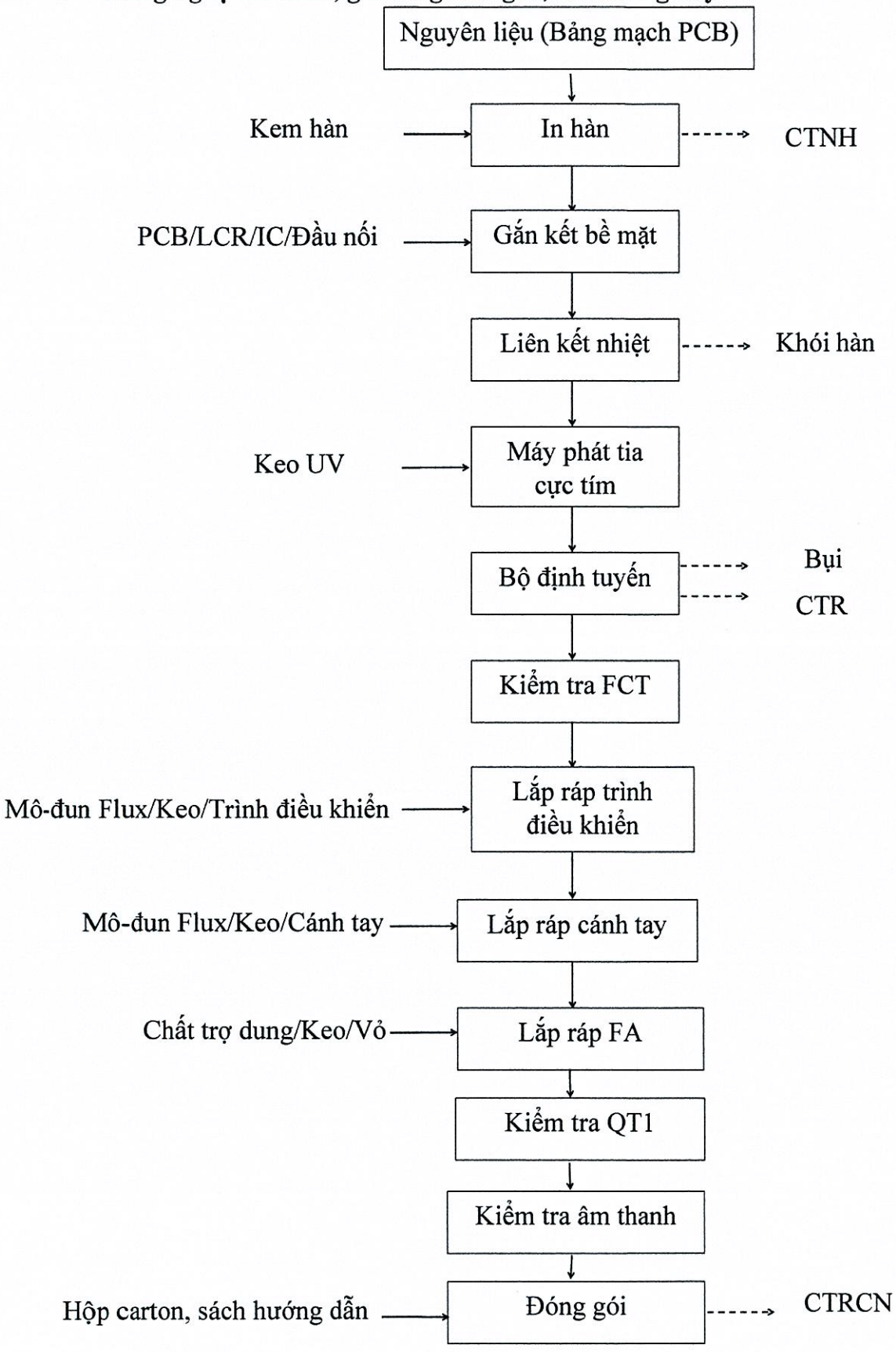
	kiện với: Lực nhấc 400-800g Độ chính xác trục Z 20-50µm Hệ thống nạp: Cuộn băng (8/12/16/24mm) Tùy chọn khay/ống cho IC Căn chỉnh hỗ trợ thị giác Hệ thống camera kép thực hiện: Kiểm tra dây dẫn linh kiện (2D/3D) Nhận dạng điểm chuẩn (độ phân giải 0,01mm)	Máy nhặt và đặt linh kiện
3. Liên kết nhiệt	Cơ chế liên kết nhiệt Gia nhiệt có kiểm soát làm tan chảy kem hàn để tạo thành: Mối nối kim loại (lớp IMC Cu6Sn5) Liên kết cơ học (cường độ cắt >5kg/mm²) Đặc điểm quy trình Hồ sơ nhiệt độ: Làm nóng trước: 1-3°C/giây đến 150-180°C Ngâm: 60-120 giây ở 180-200°C Nung chảy lại: Đỉnh 235-250°C (SnAgCu) Làm mát: 1-4°C/giây đến <100°C Kiểm soát khí quyển: Nitơ được thanh lọc (O_2 <500ppm) Khói được thu gom và xử lý bằng	 Cơ chế liên kết nhiệt

	đường ống	
4.Bộ định tuyến	Máy định tuyến Phân tách chính xác các PCBA được kết nối thành các đơn vị riêng lẻ, chuẩn bị chúng cho việc lắp ráp sản phẩm cuối cùng. Phế liệu cắt PCB sẽ được chuyển đến kho phế liệu bụi được thu gom và xử lý bằng đường ống	   Máy định tuyến
5. Đổ đầy	Quy trình đổ đầy (Hai bước) 1. Hệ thống phân phối tự động áp dụng đồng đều epoxy đổ đầy xung quanh chu vi của IC mục tiêu 2. Chuyển đến lò đối lưu để đóng rắn nhanh	
6. Lắp ráp bàn phím	Đặt các nút và vỏ trên lên máy đột lỗ tự động và sử dụng máy đột lỗ để nhấn nut nhằm xác nhận tính chính xác của các nút.	

7. Lắp ráp màn hình	Sử dụng đồ gá để lắp ráp màn hình vào bo mạch chủ	
8. Lắp ráp FA	Lắp ráp bo mạch chủ vào vỏ trên và vặn chặt vít*4 Gắn miếng bọt và nhãn vào vỏ dưới Lắp ráp vỏ dưới vào vỏ trên Ép nguội vỏ trên và vỏ dưới Vặn chặt vít vỏ dưới*4	
9. Kiểm tra chức năng	Kết nối máy với nguồn điện và quan sát xem có cần dòng điện không. Kiểm tra chức năng sản phẩm	
10. Laser	Sử dụng máy khắc laser để khắc laser số sê-ri sản phẩm ở vỏ dưới	
11. Lắp ráp ống kính	Lắp ống kính vào vỏ máy phía trên và quan sát xem có bất thường gì không.	

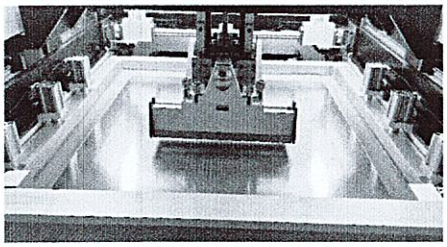
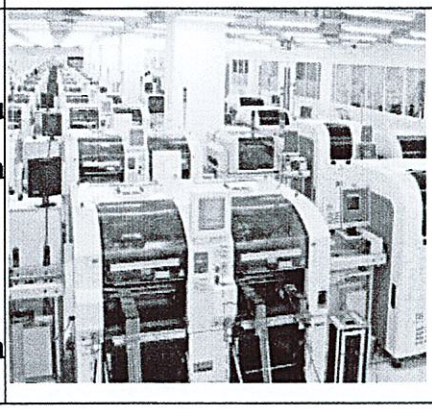
12. Đóng gói	Đóng gói các sản phẩm PASS đã thử nghiệm vào hộp quà tặng, cùng với dây đeo đồng hồ và hướng dẫn sử dụng. Sau đó, đặt các hộp quà tặng vào thùng carton chính, in nhãn, cân chúng và cuối cùng là niêm phong các thùng carton.	

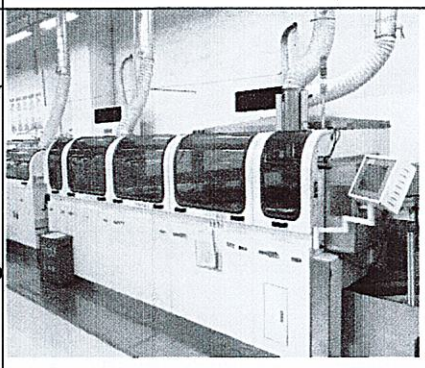
- **Công nghệ sản xuất, gia công tai nghe, loa không dây**

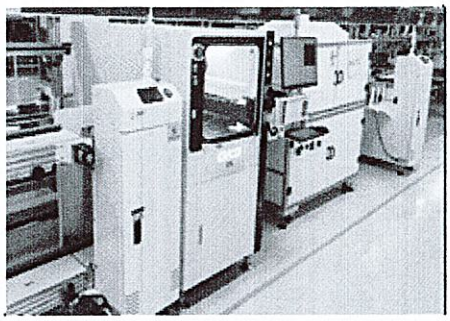
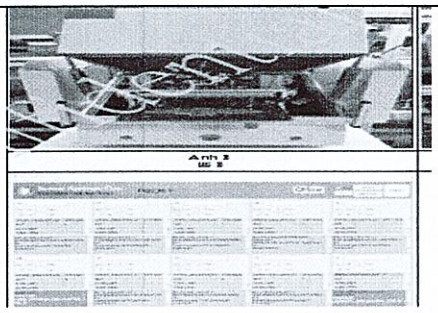


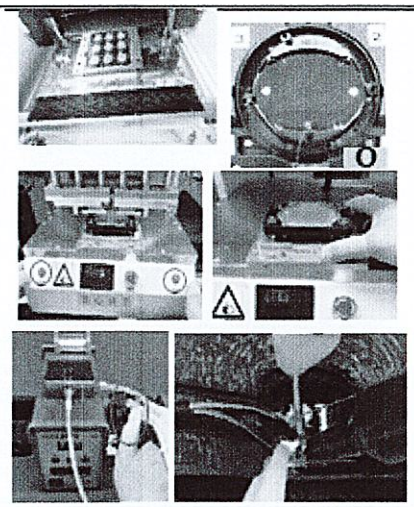
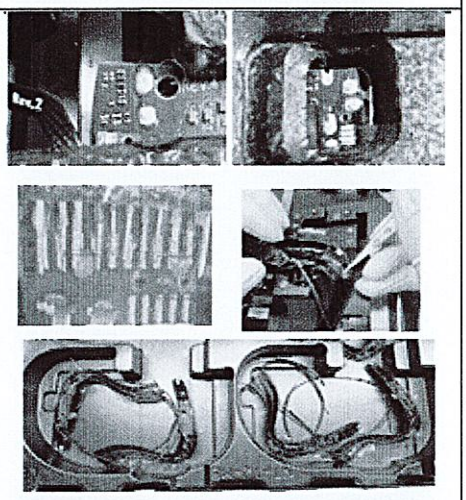
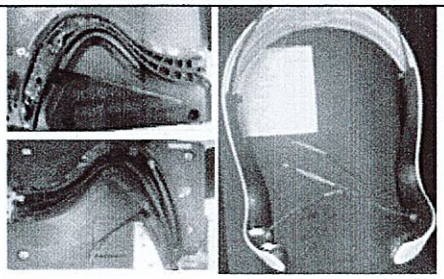
Hình 4. Quy trình sản xuất, gia công tai nghe, loa không dây

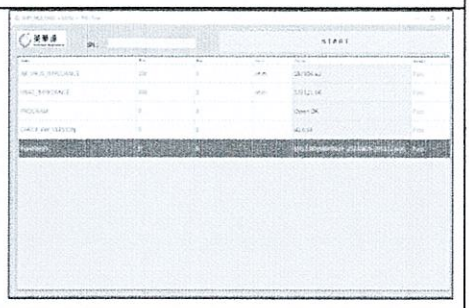
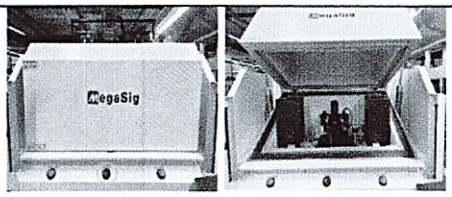
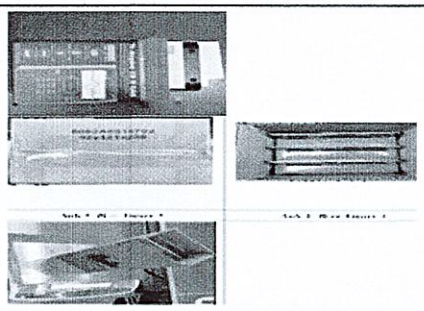
- Thuyết minh quy trình sản xuất, gia công:

Các bước	Mô tả quy trình	Ảnh minh họa
1. In hàn	Hàn chính xác 1. Kem hàn được in chính xác lên miếng đệm PCB thông qua khuôn cắt bằng laser Các thông số chính: Độ dày khuôn: 0,1-0,15mm (4-6 mil) Kích thước khẩu độ: 95% diện tích miếng đệm (bước tối thiểu 0,2mm) Căn chỉnh PCB được cố định trên máy in bằng lực giữ chân không Hệ thống Vision đạt được sự căn chỉnh khuôn với miếng đệm <±25µm Dụng cụ: Đăng ký cơ học 3 điểm Căn chỉnh camera chuẩn tùy chọn Hoạt động của gạt Hai gạt bằng thép không gỉ (góc 60°) tạo lực 5-15kg Tốc độ in: 20-80mm/giây	  Máy in kem hàn
2. Gắn kết bề mặt	Vị trí linh kiện chính xác Thiết bị gắn trên bề mặt (điện trở, tụ điện, IC) được định vị chính xác trên các miếng đệm PCB được hàn Hoạt động Pick-and-Place Vòi phun chân không xử lý các linh	

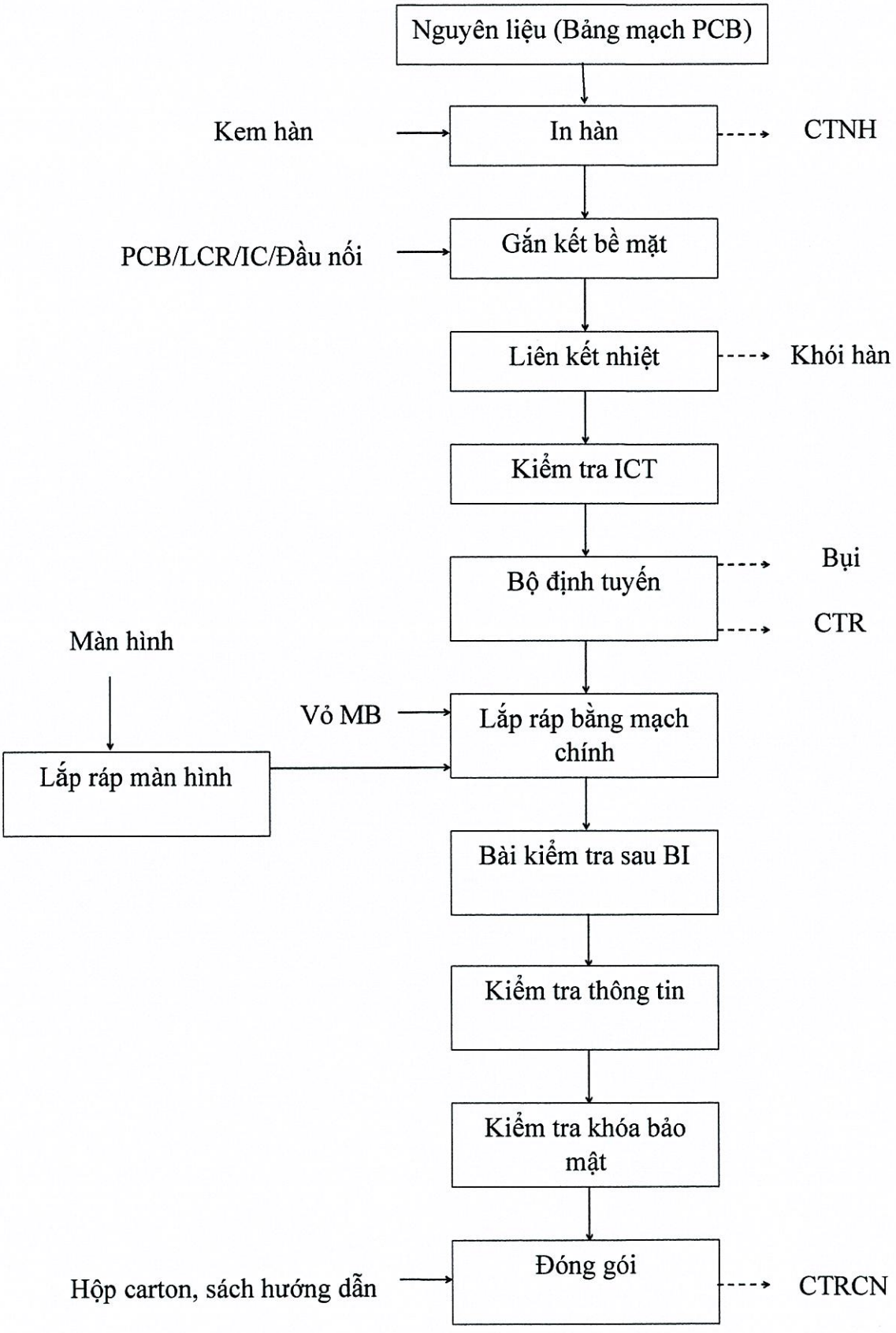
	kiện với: Lực nhấc 400-800g Độ chính xác trục Z 20-50µm Hệ thống nạp: Cuộn băng (8/12/16/24mm) Tùy chọn khay/ống cho IC Căn chỉnh hỗ trợ thị giác Hệ thống camera kép thực hiện: Kiểm tra dây dẫn linh kiện (2D/3D) Nhận dạng điểm chuẩn (độ phân giải 0,01mm)	Máy nhặt và đặt linh kiện
4. Liên kết nhiệt	Cơ chế liên kết nhiệt Gia nhiệt có kiểm soát làm tan chảy kem hàn để tạo thành: Mối nối kim loại (lớp IMC Cu6Sn5) Liên kết cơ học (cường độ cắt >5kg/mm²) Đặc điểm quy trình Hồ sơ nhiệt độ: Làm nóng trước: 1-3°C/giây đến 150-180°C Ngâm: 60-120 giây ở 180-200°C Nung chảy lại: Đỉnh 235-250°C (SnAgCu) Làm mát: 1-4°C/giây đến <100°C Kiểm soát khí quyển: Nitơ được thanh lọc (O_2 <500ppm) Khói được thu gom và xử lý bằng	 Cơ chế liên kết nhiệt

	đường ống	
4.Máy phát tia cực tím	Quy trình UV (Hai bước) 1. Hệ thống phân phối tự động áp dụng đồng đều keo UV xung quanh IC 2. Chuyển đến lò đối lưu để đóng rắn nhanh hơn	
5. Máy định tuyến laser	Hệ thống cắt laser Phân tách chính xác các PCBA được kết nối thành các đơn vị riêng lẻ, chuẩn bị chúng cho việc lắp ráp sản phẩm cuối cùng. Phế liệu cắt PCB sẽ được chuyển đến kho phế liệu	
6. Kiểm tra FCT	Kiểm tra chức năng tự động được thực hiện trên các cụm PCB đã hoàn thiện bằng cách sử dụng phần mềm và đồ gá kiểm tra chuyên dụng. Quy trình bao gồm: Lập trình phần mềm cơ sở Xác thực nguồn - Đo điện áp/dòng điện Kiểm tra giao tiếp - Xác minh giao thức (UART/I2C/SPI)	 Kiểm tra chức năng PCBA

	Kiểm tra chức năng tương tự - Xác thực tính toàn vẹn của tín hiệu và hiệu suất	
7. Lắp ráp trình điều khiển	Quy trình lắp ráp mô-đun trình điều khiển: 1. Đục tấm ổ đĩa 2. Đinh tán trình điều khiển 3. Hàn cáp trình điều khiển 4. Phân phối tự động: Keo PUR trên đế trình điều khiển và nam châm lắp ráp * 4 bộ 5. Làm đông trong 40 phút	
8. Lắp ráp cánh tay	Quy trình lắp ráp tay 1. Thanh nóng và điều khiển FPC trên bo mạch chủ 2. Hàn ăng ten *2 trên bo mạch chủ 3. Cáp chính và cáp bên phải thanh nóng 4. Lắp ráp ăng ten trên tay R 5. Kiểm tra chức năng	
9. Lắp ráp FA	Quy trình liên kết tay và băng đầu (3 bước) 1. Phân phối tự động: Thoa đều keo dán PUR lên khu vực rãnh tay bằng hệ thống phân phối tự động. 2. Lắp ráp tay với băng đầu. 3. Làm đông & ổn định: Sử dụng kẹp cố định làm đông tay và băng đầu, làm	

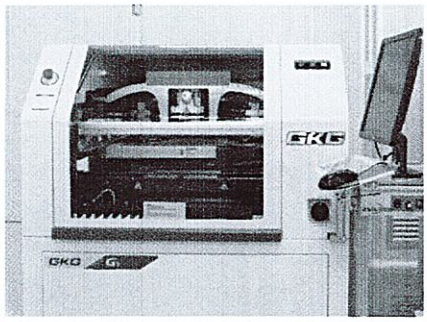
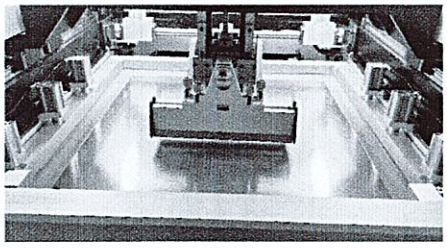
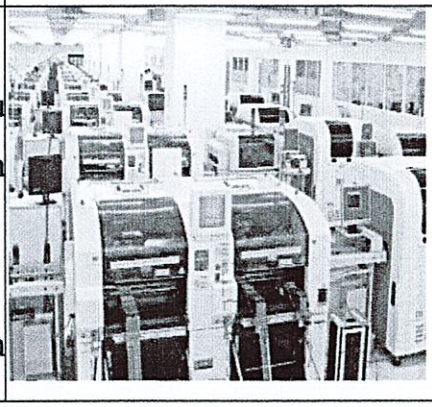
	đông trong 40 phút.	
10. Kiểm tra QT1	Được sử dụng để kiểm tra chức năng của các thiết bị lắp ráp hoàn chỉnh. Sử dụng các thiết bị kiểm tra tự động chuyên dụng và phần mềm để tự động thực hiện các thử nghiệm chức năng mô phỏng, bao gồm âm thanh, Loa, Mic, pin	
11. Kiểm tra âm thanh	Được sử dụng để kiểm tra chức năng của các thiết bị lắp ráp hoàn chỉnh. Sử dụng các thiết bị kiểm tra tự động chuyên dụng và phần mềm để tự động thực hiện các thử nghiệm chức năng mô phỏng, bao gồm âm thanh (Trình điều khiển, SPK, Mic）	
12. Đóng gói	Đóng gói các sản phẩm PASS đã thử nghiệm vào hộp quà tặng, cùng với dây đeo đồng hồ và hướng dẫn sử dụng. Sau đó, đặt các hộp quà tặng vào thùng carton chính, in nhãn, cân chúng và cuối cùng là niêm phong các thùng carton	

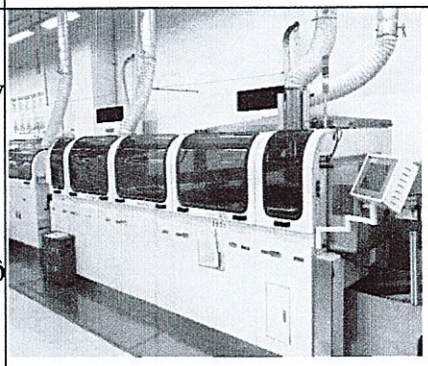
- **Công nghệ sản xuất, gia công máy quẹt thẻ**

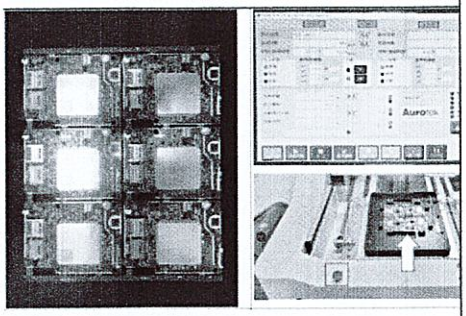
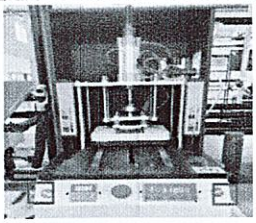
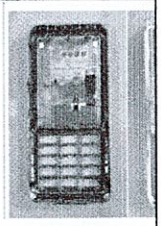
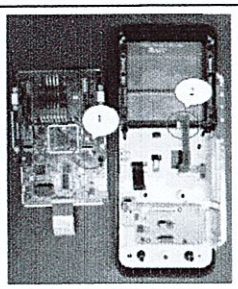
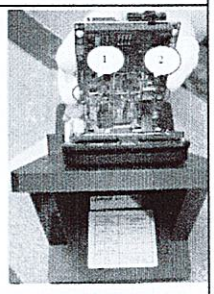


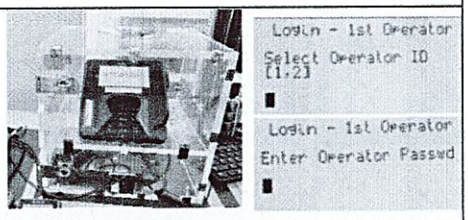
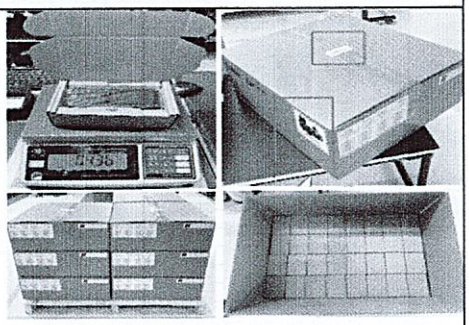
Hình 5. Quy trình sản xuất, gia công máy quẹt thẻ

- Thuyết minh quy trình sản xuất:

Các bước	Mô tả quy trình	Ảnh minh họa
1. In hàn	Hàn chính xác 1. Kem hàn được in chính xác lên miếng đệm PCB thông qua khuôn cắt bằng laser Các thông số chính: Độ dày khuôn: 0,1-0,15mm (4-6 mil) Kích thước khẩu độ: 95% diện tích miếng đệm (bước tối thiểu 0,2mm) Căn chỉnh PCB được cố định trên máy in bằng lực giữ chân không Hệ thống Vision đạt được sự căn chỉnh khuôn với miếng đệm <±25µm Dụng cụ: Đăng ký cơ học 3 điểm Căn chỉnh camera chuẩn tùy chọn Hoạt động của gạt Hai gạt bằng thép không gỉ (góc 60°) tạo lực 5-15kg Tốc độ in: 20-80mm/giây	  Máy in kem hàn
2. Gắn kết bề mặt	Vị trí linh kiện chính xác Thiết bị gắn trên bề mặt (điện trở, tụ điện, IC) được định vị chính xác trên các miếng đệm PCB được hàn Hoạt động Pick-and-Place Vòi phun chân không xử lý các linh	

	kiện với: Lực nhấc 400-800g Độ chính xác trục Z 20-50µm Hệ thống nạp: Cuộn băng (8/12/16/24mm) Tùy chọn khay/ống cho IC Căn chỉnh hỗ trợ thị giác Hệ thống camera kép thực hiện: Kiểm tra dây dẫn linh kiện (2D/3D) Nhận dạng điểm chuẩn (độ phân giải 0,01mm)	Máy nhặt và đặt linh kiện
3. Liên kết nhiệt	Cơ chế liên kết nhiệt Gia nhiệt có kiểm soát làm tan chảy kem hàn để tạo thành: Mối nối kim loại (lớp IMC Cu6Sn5) Liên kết cơ học (cường độ cắt >5kg/mm²) Đặc điểm quy trình Hồ sơ nhiệt độ: Làm nóng trước: 1-3°C/giây đến 150-180°C Ngâm: 60-120 giây ở 180-200°C Nung chảy lại: Đỉnh 235-250°C (SnAgCu) Làm mát: 1-4°C/giây đến <100°C Kiểm soát khí quyển: Nitơ được thanh lọc (O_2 <500ppm) Khói được thu gom và xử lý bằng	 Cơ chế liên kết nhiệt

	đường ống	
4.Bộ định tuyến	Máy định tuyến Phân tách chính xác các PCBA được kết nối thành các đơn vị riêng lẻ, chuẩn bị chúng cho việc lắp ráp sản phẩm cuối cùng. Phế liệu cắt PCB sẽ được chuyển đến kho phế liệu Bụi được thu gom và xử lý bằng đường ống	
5. Lắp ráp màn hình	Sử dụng đồ gá để lắp ráp màn hình vào bo mạch chủ	 
6. Lắp ráp bảng mạch chính	Lắp bảng mạch chính vào vỏ máy phía trên và quan sát xem có bất thường gì không	 
7. Bài kiểm tra sau BI	Kết nối máy với nguồn điện và kiểm tra mọi chức năng.	 

8. Kiểm tra thông tin	Tải thông tin vào hệ thống kiểm tra	
9. Kiểm tra khóa bảo mật	Tải xuống khóa bảo mật do khách hàng cung cấp	
10. Đóng gói	Đóng gói các sản phẩm PASS đã thử nghiệm vào hộp quà tặng và hướng dẫn sử dụng. Sau đó, đặt các hộp quà tặng vào thùng carton chính, in nhãn, cân chúng và cuối cùng là niêm phong các thùng carton	

- **Công nghệ sản xuất, gia công cụm sấy của máy in; Sản xuất, gia công bộ phận băng tải chuyển hình của máy in; Sản xuất, gia công khung máy in**

- Vì 03 mục tiêu sản xuất gồm: Sản xuất, gia công cụm sấy của máy in; Sản xuất, gia công bộ phận băng tải chuyển hình của máy in; Sản xuất, gia công khung máy in đều là các cụm chi tiết cơ khí của máy in, có cấu tạo và quy trình gia công tương tự nhau nên Công ty áp dụng chung một quy trình sản xuất như sau:

- Các sản phẩm trên đều là các cụm, chi tiết cơ khí dùng để lắp ráp hoàn chỉnh máy in, được cấu thành chủ yếu từ khung kim loại, trục, bánh răng, con lăn, vòng bi, lò xo, tấm dẫn hướng, bộ phận gia nhiệt, dây điện và các linh kiện cơ khí khác. Các công đoạn sản xuất tương đồng với hoạt động gia công cơ khí, lắp ráp, hoàn thiện sản phẩm điện tử và thiết bị ngoại vi mà Nhà máy đang thực hiện.

- Quy trình sản xuất – gia công chi tiết:

Bước 1: Tiếp nhận linh kiện và kiểm tra đầu vào

Bước 2: Gia công cơ khí tinh

Bước 3: Làm sạch chi tiết

Bước 4: Lắp ráp các cụm chi tiết

Bước 5: Kiểm tra kích thước và ngoại quan

Bước 6: Kiểm tra chức năng

Bước 7: Hoàn thiện và đóng gói

- Sơ đồ tóm tắt quy trình:

Tiếp nhận linh kiện → Gia công cơ khí→ Làm sạch → Lắp ráp → Kiểm tra → Đóng gói

- **Công nghệ sản xuất, gia công module truyền thông không dây, module Wi-Fi, Bluetooth, RF module, bo mạch điện tử, cảm biến và các linh kiện điện tử khác**

- Đây là nhóm sản phẩm điện tử gồm các module truyền thông, bo mạch điện tử, cảm biến và linh kiện điện tử được cấu thành từ PCB, IC, chip xử lý, module RF, module Wi-Fi, Bluetooth, anten, đầu nối và các linh kiện điện tử khác.

- Công nghệ sản xuất mang tính lắp ráp điện tử, tương đồng với hoạt động sản xuất bảng mạch điện tử, camera hành trình, thiết bị điện tử đeo thông minh, thiết bị ngoại vi máy tính và các module điện tử mà Nhà máy đang thực hiện.

- Quy trình sản xuất – gia công chi tiết

Bước 1: Chuẩn bị linh kiện, vật tư đầu vào

Bước 2: In kem hàn lên bảng mạch và gắn linh kiện điện tử dán bề mặt (Surface Mount Technology - SMT)

Bước 3: Lắp ráp và hàn linh kiện xuyên lỗ trên bảng mạch điện tử (Dual In-line Package - DIP)

Bước 4: Kiểm tra quang học tự động và kiểm tra mạch điện sau lắp ráp (Automated Optical Inspection - AOI; In-Circuit Test - ICT)

Bước 5: Lắp ráp mô-đun điện tử và các linh kiện chức năng

Bước 6: Nạp chương trình điều khiển (Firmware) và cấu hình thiết bị (nếu có)

Bước 7: Kiểm tra chức năng truyền thông không dây, bao gồm kiểm tra kết nối Wi-Fi, Bluetooth, sóng vô tuyến (RF) và các giao thức truyền thông khác theo yêu cầu của từng sản phẩm

Bước 8: Kiểm tra chức năng tổng thể của sản phẩm, kiểm tra chất lượng, chạy thử và đánh giá độ ổn định trước khi xuất xưởng

Bước 9: Hoàn thiện sản phẩm, dán tem nhãn và đóng gói thành phẩm

- Sơ đồ tóm tắt quy trình:

Chuẩn bị linh kiện, vật tư đầu vào → In kem hàn và gắn linh kiện điện tử dán bề mặt → Lắp ráp linh kiện xuyên lỗ → Kiểm tra quang học tự động và kiểm tra mạch điện → Lắp ráp mô-đun điện tử → Nạp chương trình điều khiển (nếu có) → Kiểm tra chức năng truyền thông → Kiểm tra chất lượng và chạy thử → Hoàn thiện, đóng gói thành phẩm.

- **Công nghệ sản xuất, gia công các sản phẩm (...)**

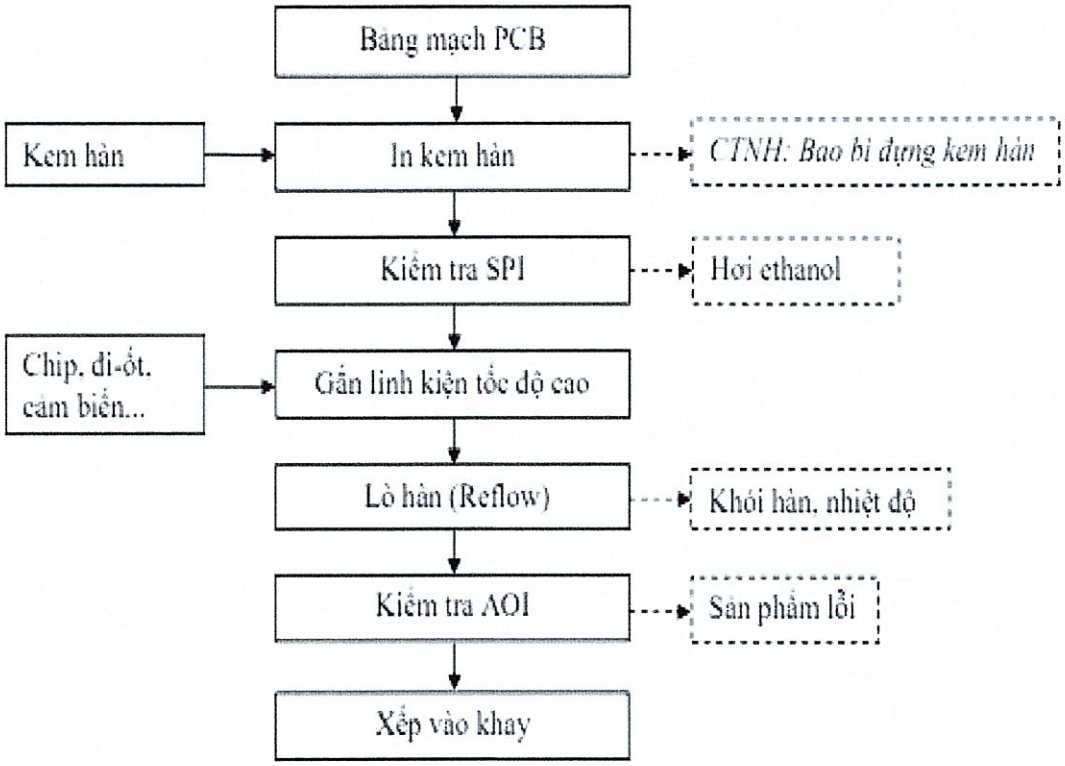
- Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm còn lại tại nhà máy được thực hiện qua hai công đoạn chính gồm có:

Công đoạn 1: Sản xuất bảng mạch (SMT – chế tạo bản mạch hoàn toàn tự động), các bán thành phẩm tại nhà máy là các bảng mạch theo yêu cầu của khách hàng đối với từng loại sản phẩm khác nhau.

Công đoạn 2: Lắp ráp sản phẩm (tùy theo từng loại sản phẩm mà sẽ được lắp đặt thủ công bởi các công nhân).

- Quy trình sản xuất sản xuất bảng mạch SMT (bán thành phẩm):

Quy trình công nghệ sản xuất bảng mạch SMT được mô tả trong sơ đồ sau:



Hình 6. Quy trình sản xuất, gia công bản mạch SMT (bán thành phẩm)

Thuyết minh quy trình sản xuất:

Các công đoạn của dây chuyền sản xuất SMT được thực hiện tự động và theo các trình tự như sau:

+ In kem hàn lên bảng mạch PCB: Bản mạch được đưa qua máy in kem hàn tự động. Tại đây, ở những vị trí gắn linh kiện, kem hàn sẽ được phủ lên.

+ Kiểm tra SPI: Sau khi in kem hàn, bản mạch được đưa qua thiết bị kiểm tra quang học tự động (SPI) để kiểm tra lớp kem hàn sau khi in trên bản mạch (kiểm tra xem các vị trí cần gắn linh kiện đã được in kem hàn chưa, kem hàn có bị lem nhòe ra các vị trí khác không gắn linh kiện không). Đối với những vị trí lớp in kem hàn bị nhòe ra ngoài sẽ dược công nhân dùng tăm bông nhúng vào chất làm sạch và làm sạch phần kem bị nhòe ra ngoài.

+ Gắn linh kiện tốc độ cao: Trong công đoạn này, các linh kiện được máy gắn tự động vào các vị trí đã được in kem hàn trên bản mạch.

+ Lò hàn (reflow): Sau khi được gắn linh kiện, bảng mạch được chuyển sang máy sấy (thiết bị reflow) trong thời gian và nhiệt độ nhất định để làm khô kem hàn nhằm tạo kết dính vững chắc giữa các linh kiện và bảng mạch PCB.

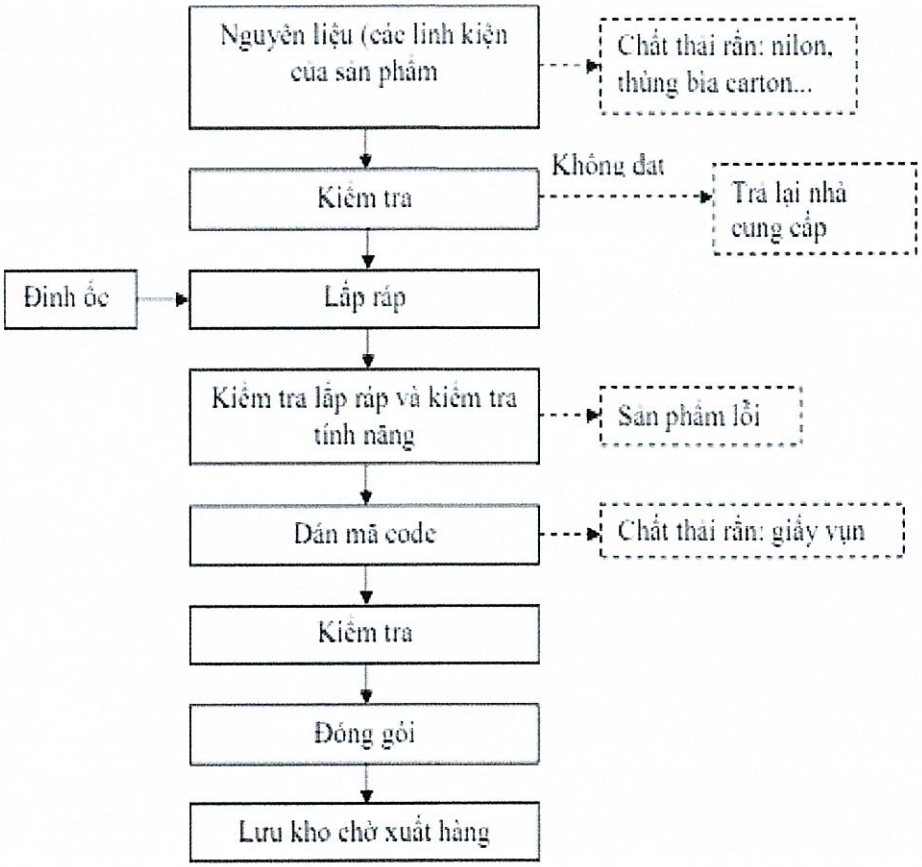
+ Kiểm tra AOI: Bản mạch từ máy sấy kem hàn được chuyển sang thiết bị kiểm tra quang học tự động AOI nhằm kiểm tra vị trí gắn linh kiện, tình trạng mối hàn thông qua các hình ảnh quang học.

Các bản mạch đạt yêu cầu được xếp vào khay và chuyển sang bộ phận lắp ráp để tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh hoặc được đóng gói để chuyển cho khách hàng (đây là bán thành phẩm của các sản phẩm tại nhà máy).

* Vệ sinh khuôn in kem hàn: Để giảm thiểu hàng lỗi trong quá trình sản xuất, Công ty cho công nhân vệ sinh khuôn in kem hàn sau mỗi ca làm việc. Công việc này được thực hiện như sau: Công nhân dùng giẻ lau tẩm hóa chất tẩy rửa (dung dịch Ethanol) để làm sạch kem hàn bám trên bề mặt khuôn.

- Quy trình lắp ráp hoàn thiện sản phẩm:

Các bản mạch điện tử của các loại sản phẩm tại nhà máy (điện thoại thông minh, máy lọc không khí, loa không dây, bảng mạch điện tử, thiết bị ngoại vi máy tính ...) sau khi được gắn linh kiện tại dây chuyền SMT sẽ tiếp tục được đưa vào dây chuyền lắp ráp để hoàn thiện sản phẩm như sau:



Hình 7. Quy trình lắp ráp hoàn thiện sản phẩm

Thuyết minh quy trình sản xuất:

Các vật liệu khác lắp ráp tạo thành điện thoại thông minh, máy lọc không khí, loa không dây, bảng mạch điện tử, thiết bị ngoại vi máy tính ... và bảng mạch từ dây chuyền sản xuất SMT của nhà máy được kiểm tra ngoại quan, kiểm tra đặc tính đối với từng loại. Các nguyên liệu không đạt yêu cầu được trả lại cho nhà cung cấp, các nguyên liệu đạt yêu cầu được đưa vào quy trình lắp ráp.

Quá trình lắp ráp sử dụng phương pháp thủ công, công nhân ở đầu chuyền sẽ sắp xếp thứ tự các linh kiện lên băng chuyền, các công nhân tiếp theo sẽ gắn các linh kiện với nhau bằng đinh ốc hoặc các khớp nối.

Sau công đoạn lắp ráp, thành phẩm được chuyển sang bộ phận kiểm tra xem đã đủ các linh kiện chưa, các đinh ốc đã được xoáy khít vào các vị trí yêu cầu không... Đồng thời, bộ phận này sẽ kiểm tra tính năng nhận tín hiệu điện của từng sản

phẩm thông qua các chương trình (phần mềm) được download về máy tính. Các sản phẩm không đạt yêu cầu được công nhân phân loại như sau:

+ Sản phẩm lỗi có thể sửa chữa → đưa lại quy trình lắp ráp để sửa chữa.

+ Sản phẩm lỗi không thể sửa chữa → bỏ vào thùng chứa chất thải để chuyển sang bộ phận thu rác xử lý.

Các sản phẩm lắp ráp đạt tiêu chuẩn được chuyển sang công đoạn dán mã code. Tại công đoạn này, công nhân sử dụng mã code dán vào từng sản phẩm, sau đó sử dụng máy scan để check mã code vừa dán.

Các sản phẩm sau khi hoàn thiện lắp ráp và dán mã code được chuyển sang công đoạn đóng gói vào thùng carton. Sau đó, các thùng carton này được chuyển vào kho sản phẩm để chờ xuất cho khách hàng.

- Đã được cấp Giấy phép môi trường số 43/GPMT-CNCCN ngày 29/9/2025 của Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp (kèm bản sao Giấy phép môi trường).

2. Nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng và các sản phẩm của dự án đầu tư, cơ sở

- **Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu**

Bảng 1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu phục vụ cho nhà máy dự kiến theo năm

STT	Nguyên liệu	Đơn vị	Số lượng
1.	Kim loại (nhôm hoặc thép không gỉ)	Bộ	12.000.000
2.	Nhựa (PC hoặc ABS)	Bộ	12.000.000
3.	Màn hình	Bộ	12.000.000
4.	Pin	Bộ	12.000.000
5.	Bo mạch in lắp ráp	Bộ	12.000.000
6.	Bìa carton, giấy	Bộ	12.000.000

STT	Nguyên liệu	Đơn vị	Số lượng
7.	Nylon	Bộ	12.000.000
8.	Pallet	Bộ	12.000.000

- **Nhu cầu sử dụng hóa chất**

STT	Tên thương mại	Thông tin hóa chất/tên thành phần	Nhu cầu sử dụng hiện tại (kg/năm)	Nhu cầu sử dụng với công suất 12.000.000 sản phẩm/năm (kg/năm)	Mục đích sử dụng
1	SCC3 phủ bóng đá phù hợp	Ethylbenzene 2-Propanol, 1-methoxy- Hexane Cyclohexane Xylene Heptane C10-13-Alkyl derivs of benzene	0,97	4,58	Chất kết dính và chất bịt kín
2	LOCTITE 4310 BO1OZEN	Hydroquinone Ethyl 2-cyanoacrylate Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide	22,64	106,86	Chất kết dính và chất bịt kín
3	Hysol UF3810	Oxiran-2-ylmethyl methacrylate	22,00	103,84	Chất kết dính và chất

STT	Tên thương mại	Thông tin hóa chất/tên thành phần	Nhu cầu sử dụng hiện tại (kg/năm)	Nhu cầu sử dụng với công suất 12.000.000 sản phẩm/năm (kg/năm)	Mục đích sử dụng
		Hydroquinone			bịt kín
		2,2-bis[4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]propane			
		Poly[2-(chloromethyl)oxirane-alt-4,4'-(propane-2,2-diyl)diphenol]			
		Peroxyhexanoic acid, 2-ethyl-, tert-butyl ester			
		P-tert-butylphenyl 1-(2,3-epoxy)propyl ether			
		Octahydro-4,7-methano-1H-indene-5,?-diylbis(methylene) diacrylate			
		Ester of acrylic acid and [polymer of 2-(chloromethyl)oxirane / 4,4'-isopropylidenediphenol]			

STT	Tên thương mại	Thông tin hóa chất/tên thành phần	Nhu cầu sử dụng hiện tại (kg/năm)	Nhu cầu sử dụng với công suất 12.000.000 sản phẩm/năm (kg/năm)	Mục đích sử dụng
		(1R,2R,4R)-rel-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl methacrylate			
		Formaldehyde, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane and phenol			
5	Dung dịch tẩy rửa F-102	Ethanol, Cồn, Rượu	1.200,00	5.664	Sản phẩm giặt và làm sạch sử dụng trong công nghiệp
		Propan-2-ol			
		1-Butanol			
6	Natri Hypochlorit	Sodium hydroxide	108,00	509,76	Hóa chất xử lý nước
		Sodium hypochlorite			
		Water			
7	Sodium Hydroxide	Sodium hydroxide	875	4.130	Hóa chất xử lý nước
8	DELO-DUOPOX®	Titanium dioxide	1,57	7,41	Chất kết dính và chất bịt kín
		2,2-bis[4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]propan			

STT	Tên thương mại	Thông tin hóa chất/tên thành phần	Nhu cầu sử dụng hiện tại (kg/năm)	Nhu cầu sử dụng với công suất 12.000.000 sản phẩm/năm (kg/năm)	Mục đích sử dụng
	AD895 Thành phần	e			
		3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine			
		2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene, carboxy-terminated, polymers with bisphenol A and epichlorohydrin			
		Formaldehyde, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane and phenol			
		Oxirane, 2-(chloromethyl)-, polymer with .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]			
		1,6-Hexanediol, reaction products with			

STT	Tên thương mại	Thông tin hóa chất/tên thành phần	Nhu cầu sử dụng hiện tại (kg/năm)	Nhu cầu sử dụng với công suất 12.000.000 sản phẩm/năm (kg/năm)	Mục đích sử dụng
		epichlorohydrin			
9	Dung dịch tẩy rửa JS-101 B	Ethanol, Cồn, Rượu Propan-2-ol 1-Butanol	1.200,00	5.664	Sản phẩm giặt và làm sạch sử dụng trong công nghiệp
10	Chất tẩy rửa hòa tan trong nước F205	Triethanolamine 2-Butoxyethanol Propan-2-ol Water	1.920,00	9.062,4	Sản phẩm giặt và làm sạch sử dụng trong công nghiệp
12	WELD BOND 2209	Bis(4-isocyanatophenyl)methane Propanol, [(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis(oxy)]bis-, polymer with 1,1'-methylenebis[isocyanatobenzene] and oxybis[propanol]	10,09	47,62	Chất kết dính và chất bịt kín

STT	Tên thương mại	Thông tin hóa chất/tên thành phần	Nhu cầu sử dụng hiện tại (kg/năm)	Nhu cầu sử dụng với công suất 12.000.000 sản phẩm/năm (kg/năm)	Mục đích sử dụng
13	WELD BOND 5354	Bis(4-isocyanatophenyl)methane Propanol, [(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis(oxy)]bis-, polymer with 1,1'-methylenebis[isocyanatobenzene] and oxybis[propanol]	4,20	19,8	Chất kết dính và chất bịt kín
15	Poly aluminium chloride	Poly aluminum chloride	1.200,00	5.664	Hóa chất xử lý nước
16	Cồn Ethanol	Ethanol, Cồn, Rượu	1.900,00	8.968	Sản phẩm giặt và làm sạch sử dụng trong công nghiệp
18	Keo hàn không chì	[2-(2-Butoxymethylethoxy)methylethoxy]-propanol	300,00	1.416	Chất kết dính và chất bịt kín

STT	Tên thương mại	Thông tin hóa chất/tên thành phần	Nhu cầu sử dụng hiện tại (kg/năm)	Nhu cầu sử dụng với công suất 12.000.000 sản phẩm/năm (kg/năm)	Mục đích sử dụng
	ALPHA OM340	Silver Tin Copper			
19	Cồn công nghiệp 99.8%	Ethanol, Cồn, Rượu Water	1.100,00	5.192	Sản phẩm giặt và làm sạch sử dụng trong công nghiệp
20	Hysol UF3808	Poly[2-(chloromethyl)oxirane-alt-4,4'-(propane-2,2-diyl)diphenol] Peroxyhexanoic acid, 2-ethyl-, tert-butyl ester 2,2'-[methylenebis(phenyleneoxymethylene)]bisoxirane (1R,2R,4R)-rel-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl methacrylate	0,03	0,14	Chất kết dính và chất bịt kín

STT	Tên thương mại	Thông tin hóa chất/tên thành phần	Nhu cầu sử dụng hiện tại (kg/năm)	Nhu cầu sử dụng với công suất 12.000.000 sản phẩm/năm (kg/năm)	Mục đích sử dụng
		Formaldehyde, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane and phenol			
21	Hysol UF3808	Poly[2-(chloromethyl)oxirane-alt-4,4'-(propane-2,2-diyl)diphenol]	26,00	122,72	Chất kết dính và chất bịt kín
		Peroxyhexanoic acid, 2-ethyl-, tert-butyl ester			
		2,2'-[methylenebis(phenyleneoxymethylene)]bisoxirane			
		(1R,2R,4R)-rel-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl methacrylate			
		Formaldehyde, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane and phenol			

STT	Tên thương mại	Thông tin hóa chất/tên thành phần	Nhu cầu sử dụng hiện tại (kg/năm)	Nhu cầu sử dụng với công suất 12.000.000 sản phẩm/năm (kg/năm)	Mục đích sử dụng
22	Keo dán 6100LV	Poly[2-(chloromethyl)oxirane-alt-4,4'-(propane-2,2-diyl)diphenol]	12,21	57,63	Chất kết dính và chất bịt kín
		2-{[3-(Trimethoxysilyl)propoxy]methyl}oxirane			
		2-ethyl-2-[(3-mercapto-1-oxopropoxy)methyl]propane-1,3-diyl bis[3-mercaptopropionate]			
		Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane and 2-methyloxirane			
24	Kem hàn	2-[2-(Hexan-1-yloxy)ethoxy]ethanol	92,00	434,24	Chất kết dính và chất bịt kín
		Silver			
		Tin			
		Copper			

STT	Tên thương mại	Thông tin hóa chất/tên thành phần	Nhu cầu sử dụng hiện tại (kg/năm)	Nhu cầu sử dụng với công suất 12.000.000 sản phẩm/năm (kg/năm)	Mục đích sử dụng
		Rosin			
25	Keo dán nóng chảy polyurethane phản ứng đóng rắn bằng độ ẩm PUR	Bis(4-isocyanatophenyl)methane	0,33	1,58	Chất kết dính và chất bịt kín
26	DÁN HÀN ECO S70G-HF(CM) Type5	Silver Tin Copper	119,00	561,68	Chất kết dính và chất bịt kín
27	Dây thiếc không chì	Nickel Silver Tin Copper	805,00	3.799,6	Chất kết dính và chất bịt kín

STT	Tên thương mại	Thông tin hóa chất/tên thành phần	Nhu cầu sử dụng hiện tại (kg/năm)	Nhu cầu sử dụng với công suất 12.000.000 sản phẩm/năm (kg/năm)	Mục đích sử dụng
		Germanium			
		Rosin			
	Tổng		**10.919,04**	**51.537,86**	

(Nguồn: Báo cáo đề xuất cập Giấy phép môi trường của cơ sở)

3. Loại, khối lượng chất thải phát sinh của dự án đầu tư, cơ sở

3.1. Các nguồn nước thải của nhà máy đều thuộc dạng nước thải sinh hoạt, khối lượng nước thải khoảng 44 m3/ngày (dựa vào số liệu từ tháng 7/2026 đến tháng 9/2026) và quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng theo tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của cơ sở thứ cấp vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Quang Minh.

3.2. Nguồn khí thải phát sinh từ quy trình sản xuất bao gồm: khói hàn, CO, CO2, SO2, bụi silic, nhiệt lượng,...trong quá trình hàn. Lưu lượng khí thải phát sinh tối đa là 81.600m3/h và quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng: QCVN 19:2024/BTNMT (cột C) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp.

3.3. Loại và khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hoặc dự kiến phát sinh: Theo chứng từ bàn giao chất thải rắn sinh hoạt, khối lượng rác thải sinh hoạt năm 2025 là 32.468 kg/năm.

3.4. Loại và khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh hoặc dự kiến phát sinh:

- Chất thải rắn thông thường có khả năng tái chế

Thành phần: bìa carton, giấy vụn; sắt, thép; nylon phế liệu (nylon trắng sạch); nhựa; pallet nhựa; gỗ máy, pallet gỗ; bản mạch điện tử không chứa thành phần nguy hại; nhôm.

Theo chứng từ bàn giao chất thải rắn thông thường khối lượng chất thải rắn thông thường có khả năng tái chế được thống kê theo bảng sau:

STT	Tên chất thải	Năm 2025 (kg/năm)
1	Phế liệu bìa carton, giấy vụn	303,461
2	Phế liệu sắt, thép	333
3	Nylon phế liệu (Nylon trắng sạch)	7,634
4	Phế liệu nhựa	145,516
5	Phế liệu pallet nhựa	13,059
6	Phế liệu gỗ máy, pallet gỗ	52,818
7	Bản mạch điện tử không chứa thành phần nguy hại	10,129
8	Phế liệu nhôm	8
	Tổng	532.958

- Chất thải rắn thông thường không có khả năng tái chế

Thành phần: gỗ vụn, các loại giấy rác, nhựa không tái chế. Số lượng phát sinh năm 2025: 128,218 kg/năm.

3.5. Loại và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh hoặc dự kiến phát sinh: Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình nhà máy hoạt động chủ yếu như sau:

STT	Tên chất thải nguy hại	Trạng thái tồn tại	Khối lượng kg/năm	Mã CTNH	Ghi chú
1	Dung môi hữu cơ thải, chất tẩy rửa bản mạch (ethannol,…), chất trợ hàn	Lỏng	2,690.2	03 07 03	
2	Sơn thải	Lỏng	44.4	08 01 01	
3	Pin, ắc quy, chì thải	Rắn	3.0	19 06 01	
4	Hộp mực in thải có các thành phần nguy hại	Rắn	86.8	08 02 04	
5	Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải	Lỏng	91.2	17 02 03	
6	Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại	Rắn	759.8	18 02 01	
7	Bao bì cứng thải bằng kim loại (dính hóa chất)	Rắn	211.6	18 01 02	
8	Bao bì cứng thải bằng nhựa (dính hóa chất)	Rắn	842.6	18 01 03	
9	Bao bì cứng thải bằng vật liệu khác (composit, thủy tinh,…)	Rắn	16.0	18 01 04	
10	Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải	Rắn	49.4	16 01 06	
Tổng			**4.795**		

4. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải của dự án đầu tư, cơ sở

4.1. Phương án thu gom, quản lý, xử lý nước thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh và quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng:

- Nước thải sinh hoạt của cơ sở sẽ được thu gom bằng hệ thống thoát nước thải rồi đưa vào trạm xử lý nước thải có công suất thiết kế 130 m3/ngày.đêm, nước thải sau xử lý bơm cưỡng bức vào hệ thống thoát nước chung của khu công nghiệp. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng theo tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của cơ sở thứ cấp vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Quang Minh.

4.2. Phương án thu gom, quản lý, xử lý khí thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh và quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng:

- Khí thải phát sinh chủ yếu tại khu vực hàn và các công đoạn sử dụng keo. Tại các vị trí phát sinh, cơ sở bố trí chụp hút, quạt hút và đường ống thu gom để dẫn khí thải về hệ thống xử lý khí thải của nhà máy trước khi thải ra môi trường.

- Cơ sở thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị và hệ thống thu gom, xử lý khí thải; vận hành theo đúng quy trình kỹ thuật; vệ sinh khu vực sản xuất thường xuyên và trang bị phương tiện bảo hộ lao động phù hợp cho người lao động.

4.3. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hoặc dự kiến phát sinh:

- Thiết bị lưu giữ: sử dụng 12 thùng chuyên dụng có dung tích 60 lít đặt tại các khu vực phát sinh rác thải (ngoài trời, khu văn phòng, khu xưởng sản xuất, khu vệ sinh…) bằng nhựa có nắp đậy để thu gom tạm chứa trong ngày, sau đó được thu gom, vận chuyển đến kho chứa chất thải rắn sinh hoạt có diện tích 13,7 m^2 với tần suất 2 lần/ngày. Hàng ngày, đơn vị có chức năng đến thu gom, và mang đi xử lý theo quy định với tần suất 1 ngày/lần.

- Quy trình chuyển giao: Công ty sẽ bố trí cán bộ thu gom chất thải. Rác thải sinh hoạt cuối ngày làm việc sẽ được công nhân vệ sinh môi trường thu gom về 8 thùng rác 240 lít đặt tại nơi tập kết rác tập trung (kho chứa chất thải rắn sinh hoạt, diện tích 13,7 m^2, được xây dựng mái che, tường bao kín, nền cao tránh ngập lụt, cửa ra vào, đèn chiếu sáng...theo quy định).

- Ký hợp đồng vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt với đơn vị có chức năng theo quy định. Tần suất thu gom, vận chuyển xử lý: 1 ngày/lần.

4.4. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh hoặc dự kiến phát sinh:

- Thành phần có khả năng tái chế (thùng bìa carton, túi nilong, xốp, khay nhựa,…) sẽ được thu gom vào 8 thùng 240 lít hoặc khu chứa chất thải được ngăn cách, sáu đó chuyển giao lại cho đơn vị có chức năng tái chế;

- Thành phần không có khả năng tái chế sẽ được thu gom, chuyển giao cho đơn vị có chức năng theo đúng quy định;

- Đối với bùn thải, bùn cặn nạo vét định kỳ tại công trình xử lý nước thải, nước mưa: chủ dự án sẽ thuê đơn vị có chức năng đến nạo vét, đồng thời vận chuyển xử lý theo đúng quy định. Do đó, loại chất thải này không tồn chứa trong kho.

- Tần suất thu gom chất thải rắn sản xuất về kho chứa tối thiểu 1 lần/ngày. Khi kho đầy, công ty sẽ gọi đơn vị thu mua phế liệu đến thu gom và đem đi xử lý theo quy định.

- Kho chứa chất thải thông thường có diện tích 60,9 m2 được xây dựng mái che, tường bao kín, nền cao tránh ngập lụt, cửa ra vào, đèn chiếu sáng...theo quy định.

4.5. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải nguy hại phát sinh hoặc dự kiến phát sinh: Toàn bộ CTNH phát sinh đã được thu gom quản lý theo đúng quy định của pháp luật như Nghị định 08/2022/NĐ-CP; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Các biện pháp lưu giữ chất thải nguy hại cụ thể như sau:

- Các loại chất thải nguy hại được phân loại, đựng trong từng thùng riêng, có 5 thùng dung tích 240 lít, 5 thùng nhỏ dung tích 60 lít, 15 can nhựa 60 – 120 lít thùng chứa có nắp kín, dán nhãn và ghi rõ loại, mã của chất thải, có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707:2009 (chất thải nguy hại-dấu hiệu cảnh báo).

- Toàn bộ chất thải nguy hại được phân loại tại nguồn ngay tại nơi phát sinh. Không để chất thải nguy hại với CTR thông thường.

- Nhà máy lập sổ theo dõi chất thải nguy hại từ nơi phát sinh, thu gom, lưu giữ và hồ sơ bàn giao chất thải cho đơn vị dịch vụ được thuê xử lý.

- Kho chứa CTNH có diện tích 12,7 m^2. Kho chứa chất thải nguy hại được xây dựng mái che, tường bao kín, nền cao tránh ngập lụt, rãnh chứa chất thải lỏng, cửa ra vào, đèn chiếu sáng, biển báo... theo quy định trong Thông tư 02/2022/TT-BTNMT

- Ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH với đơn vị có chức năng theo quy định.

- Tần suất thu gom:

+ Từ vị trí phát sinh ra kho chứa: 1 lần/ca sản xuất

+ Từ nhà máy đến khu vực xử lý: theo khối lượng phát sinh

5. Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường

Công ty cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai xây dựng, lắp đặt và trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở; thực hiện đúng các nội dung đã đăng ký môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Ban Quản lý và đơn vị quản lý, vận hành hạ tầng Khu công nghiệp Quang Minh. Cụ thể như sau:

5.1. Cam kết chung về bảo vệ môi trường

- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường của Ban Quản lý, Khu công nghiệp Quang Minh trong phạm vi hoạt động của cơ sở.
- Thực hiện đúng nội dung, quy mô, công suất và các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đã đăng ký; trường hợp có thay đổi làm phát sinh vấn đề môi trường hoặc thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục môi trường khác, Công ty thực hiện theo đúng quy định trước khi triển khai.
- Bố trí nhân sự và các điều kiện cần thiết để quản lý, vận hành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động.
- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm; kiểm soát chất thải phát sinh, không để hoạt động của cơ sở gây ô nhiễm đất, nước, không khí và ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh.
- Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, giám sát về bảo vệ môi trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phối hợp, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan khi được yêu cầu theo quy định.

5.2. Cam kết trong quá trình xây dựng, lắp đặt

Trong quá trình xây dựng, cải tạo, lắp đặt máy móc, thiết bị, Công ty cam kết:

- Thực hiện các biện pháp kiểm soát bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung; hạn chế ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.
- Che chắn khu vực thi công, vệ sinh khu vực và tuyến đường vận chuyển; không để đất, cát, vật liệu xây dựng rơi vãi gây mất vệ sinh môi trường.
- Thu gom, phân loại và quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh theo quy định; không đổ, tập kết chất thải không đúng nơi quy định.
- Nước thải sinh hoạt của công nhân được thu gom và quản lý phù hợp với điều kiện hạ tầng của Khu công nghiệp; không xả trực tiếp ra môi trường.

- Sau khi hoàn thành xây dựng, lắp đặt, thu gom vật liệu, phế thải, bao bì và chất thải còn tồn tại, bảo đảm khu vực cơ sở được vệ sinh trước khi đưa vào hoạt động.

5.3. Cam kết về nước thải

- Căn cứ Điều 111 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định pháp luật hiện hành; căn cứ khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 46 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và các quy định có liên quan.
- Cơ sở phát sinh nước thải sinh hoạt với lưu lượng tối đa khoảng 130 m^3/ngày đêm. Toàn bộ nước thải được thu gom, xử lý sơ bộ và đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Quang Minh theo biên bản thỏa thuận đấu nối ký ngày 08/12/2023 và theo hợp đồng dịch vụ xử lý nước thải số 116A/2023/HĐ-XLNT ký ngày 25/05/2023 giữa Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Đức & Công ty TNHH Inventec Appliances (Việt Nam).
- Trên cơ sở các quy định nêu trên, Công ty không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải tự động, liên tục hoặc quan trắc định kỳ. Công ty thực hiện vận hành, kiểm tra, duy trì hệ thống thu gom, xử lý sơ bộ và bảo đảm nước thải trước khi đấu nối đáp ứng yêu cầu tiếp nhận của Khu công nghiệp.
- Trường hợp Khu công nghiệp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu lấy mẫu, phân tích, kiểm tra, quan trắc hoặc cung cấp thông tin liên quan đến nước thải, Công ty cam kết phối hợp thực hiện theo yêu cầu và quy định pháp luật.

5.4. Cam kết về khí thải

- Căn cứ Điều 112 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định pháp luật hiện hành; căn cứ điểm a khoản 1 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính

phủ và Mục số 8 Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 56 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ, Công ty đã rà soát các nguồn phát sinh và công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải tại cơ sở.

- Cơ sở thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II. Tuy nhiên, các công trình, thiết bị phát sinh và xử lý bụi, khí thải của cơ sở không thuộc loại công trình, thiết bị xả bụi, khí thải được quy định tại cột (3) Mục số 8 Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 56 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ. Do đó, cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục, quan trắc định kỳ theo quy định.
- Hệ thống thu gom, xử lý khí thải của Công ty có tổng lưu lượng tối đa 81.600 m^3/giờ. Công ty thực hiện vận hành, kiểm tra và duy trì hệ thống thu gom, xử lý khí thải; thực hiện các biện pháp phù hợp để hạn chế phát sinh, phát tán bụi, khói, hơi và khí thải từ hoạt động sản xuất, lắp ráp, hàn, gia nhiệt.
- Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra, lấy mẫu, phân tích, quan trắc hoặc cung cấp thông tin liên quan đến khí thải, Công ty cam kết phối hợp thực hiện theo yêu cầu và quy định pháp luật.

5.5. Cam kết về chất thải rắn

- Chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại cơ sở được phân loại, thu gom, lưu giữ và chuyển giao cho đơn vị có chức năng theo quy định; không đổ, đốt hoặc chôn lấp chất thải trái quy định.
- Công ty thực hiện vệ sinh khu vực sản xuất, kho, văn phòng và khu vực xung quanh; bảo đảm chất thải được quản lý, thu gom thường xuyên, không gây mất vệ sinh và ảnh hưởng đến môi trường.

5.6. Cam kết về chất thải nguy hại

- Chất thải nguy hại phát sinh (nếu có) được phân loại, thu gom, lưu giữ riêng, bảo đảm an toàn và chuyển giao cho đơn vị có chức năng theo đúng quy định.

- Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại được bố trí phù hợp, có biện pháp phòng ngừa rò rỉ, phát tán và thực hiện quản lý chất thải theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

5.7. Cam kết về tiếng ồn, độ rung và các tác động khác

- Công ty thực hiện các biện pháp kiểm soát tiếng ồn, độ rung phát sinh từ máy móc, thiết bị và hoạt động sản xuất; thực hiện bảo dưỡng, vận hành thiết bị phù hợp nhằm hạn chế ảnh hưởng đến người lao động, các cơ sở lân cận và môi trường xung quanh.
- Không thực hiện các hoạt động gây tiếng ồn, độ rung vượt quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

5.8. Cam kết về hóa chất và phòng ngừa sự cố môi trường

- Hóa chất sử dụng tại cơ sở được quản lý, lưu giữ, sử dụng phù hợp với tính chất và yêu cầu an toàn; thực hiện các biện pháp phòng ngừa rò rỉ, tràn đổ và sự cố môi trường.
- Khi xảy ra sự cố môi trường, Công ty thực hiện các biện pháp ứng phó, khắc phục, hạn chế phát tán chất ô nhiễm và thông báo, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

5.9. Cam kết về quản lý, giám sát và thực hiện các yêu cầu về môi trường

- Công ty cam kết thực hiện công tác quản lý, vận hành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo đúng nội dung đăng ký; thực hiện các chế độ báo cáo, cung cấp thông tin và thực hiện các yêu cầu về kiểm tra, giám sát môi trường theo quy định.
- Trường hợp pháp luật về bảo vệ môi trường có thay đổi hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Ban Quản lý hoặc đơn vị quản lý, vận hành hạ tầng Khu công nghiệp Quang Minh có yêu cầu phù hợp với quy định pháp luật, Công ty cam kết phối hợp thực hiện và thực hiện đầy đủ theo quy định, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Chúng tôi gửi kèm văn bản này 01 (một) Giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở.

Chúng tôi cam kết bảo đảm về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu được nêu trong các tài liệu nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.

Đề nghị Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội tiếp nhận đăng ký môi trường của Dự án *"Sản xuất đồ điện tử gia dụng, linh kiện và thiết bị điện tử Inventec Appliances Việt Nam"./.*

Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: ...

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CỦA CÔNG TY TNHH INVENTEC APPLIANCES (VIỆT NAM)

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

M.S.D.N: 0110113951 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TNHH INVENTEC APPLIANCES (VIỆT NAM)
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC

Wu Chieh